

決算説明会

2024年3月期 第2四半期

ミネベアミツミ株式会社

2023年11月2日

1. 業績の説明

2. 事業概況と経営戦略

業績の説明

取締役 社長執行役員 COO & CFO
吉田 勝彦

売上高は四半期として過去最高

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期		前年同期比 伸び率	前四半期比 伸び率
	2Q	1Q	2Q		
売上高	330,021	292,370	379,747	+15.1%	+29.9%
営業利益	26,331	6,052	21,110	-19.8%	3.5倍
税引前利益	28,121	7,811	22,390	-20.4%	2.9倍
親会社の所有者に帰属する 四半期利益	20,022	3,642	15,958	-20.3%	4.4倍
基本的1株当たり 四半期利益 (円)	48.53	8.92	39.17	-19.3%	4.4倍

為替レート	2023年3月期 2Q	2024年3月期 1Q	2024年3月期 2Q
US\$	135.32円	134.92円	142.47円
ユーロ	139.28円	146.23円	155.71円
タイバーツ	3.79円	3.93円	4.09円
人民元	20.05円	19.46円	19.76円

売上高は上半期として過去最高

(百万円)	2023年3月期 上半期	2024年3月期 上半期	前年同期比 伸び率	2024年3月期 上半期	
				8月予想	達成率
売上高	581,061	672,117	+15.7%	663,000	+1.4%
営業利益	40,586	27,162	-33.1%	28,000	-3.0%
税引前利益	42,395	30,201	-28.8%	26,500	+14.0%
親会社の所有者に帰属する 当期利益	30,756	19,600	-36.3%	20,000	-2.0%
基本的1株当たり 当期利益 (円)	75.13	48.06	-36.0%	48.97	-1.9%

為替レート	2023年3月期 上半期	2024年3月期 上半期
US\$	129.88円	138.70円
ユーロ	136.87円	150.97円
タイバーツ	3.74円	4.01円
人民元	19.59円	19.61円

売上高、営業利益、営業利益率

(10億円)



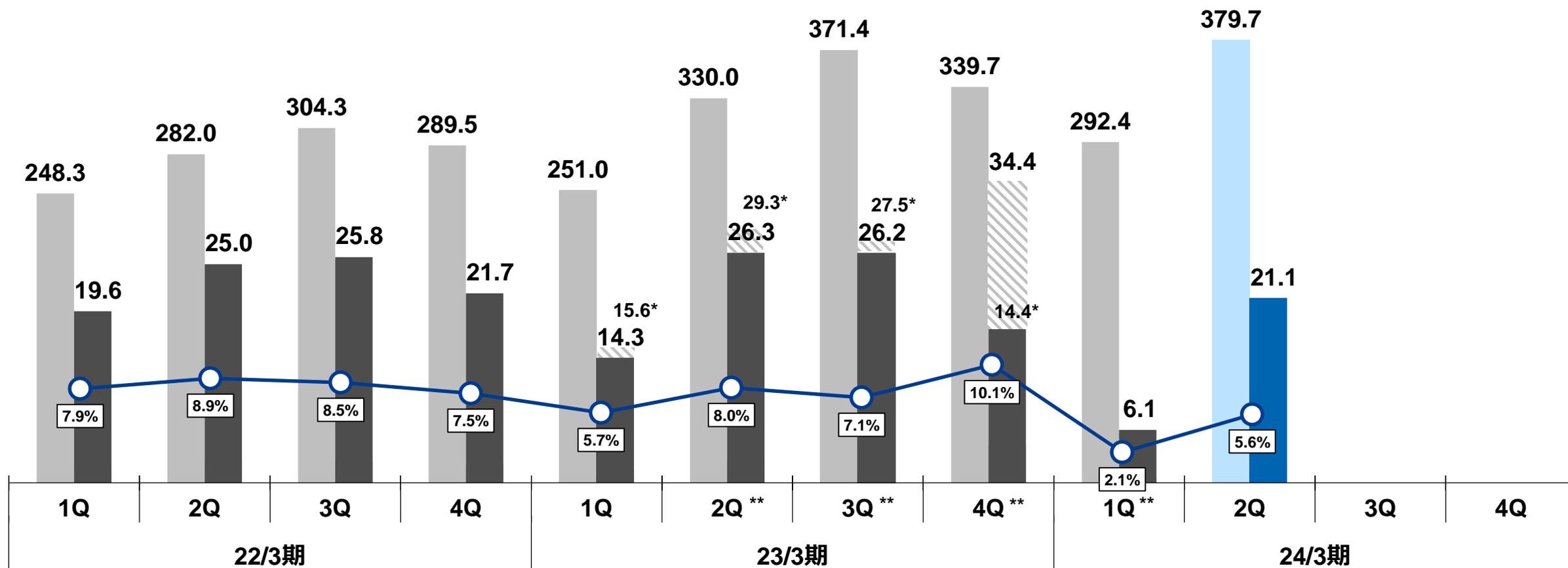
23/3期 特殊要因

	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
為替予約	△1.3	△3.0	△2.9	△1.5	△8.7
その他	-	-	1.7	21.5	23.2
合計	△1.3	△3.0	△1.3	20.0	14.5

*特殊要因除く

**本多通信工業のPPA評価完了に伴い、営業利益を遡及修正

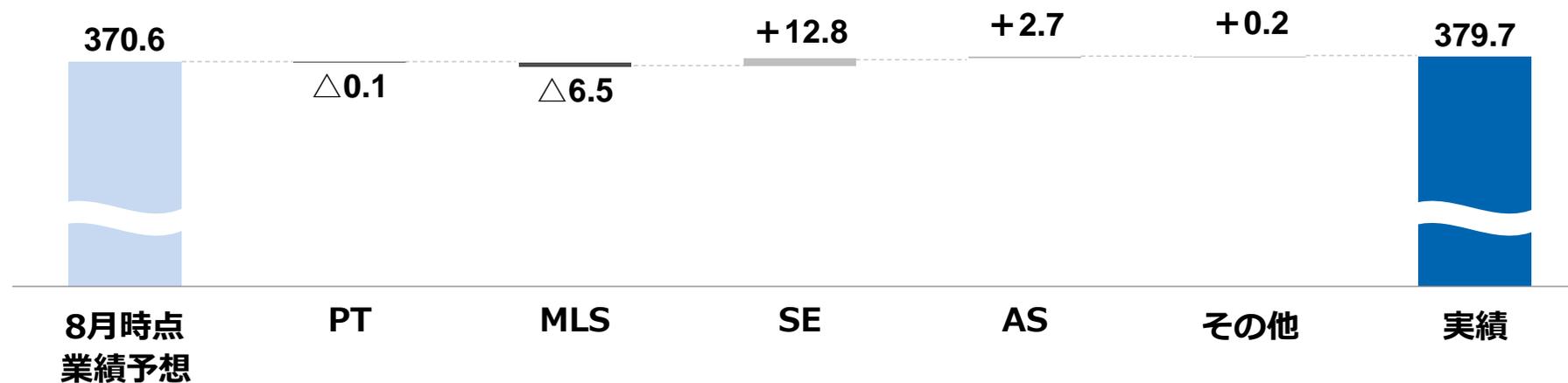
(影響額は、23/3期2Q△63百万円、3Q△183百万円、4Q△66百万円、24/3期1Q△27百万円)



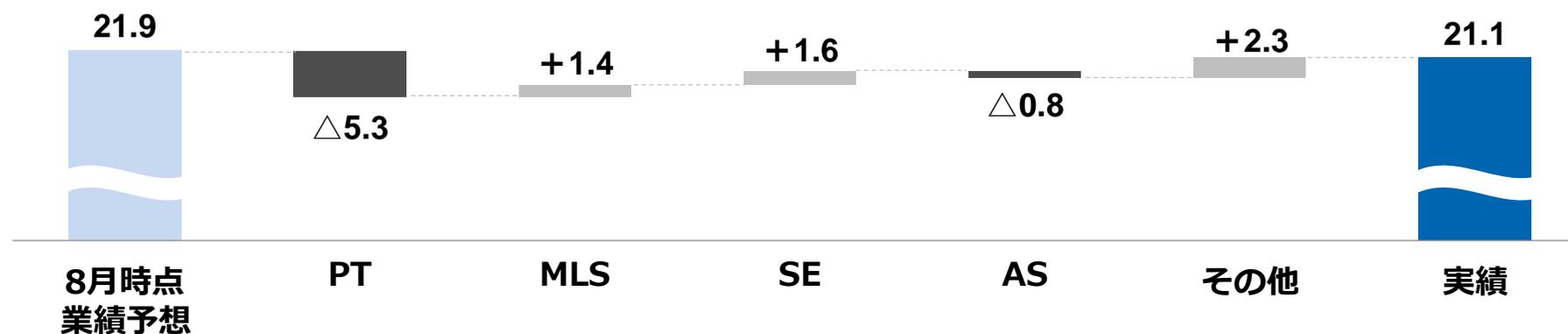
2Q実績 8月時点業績予想からの差異

(10億円)

売上高



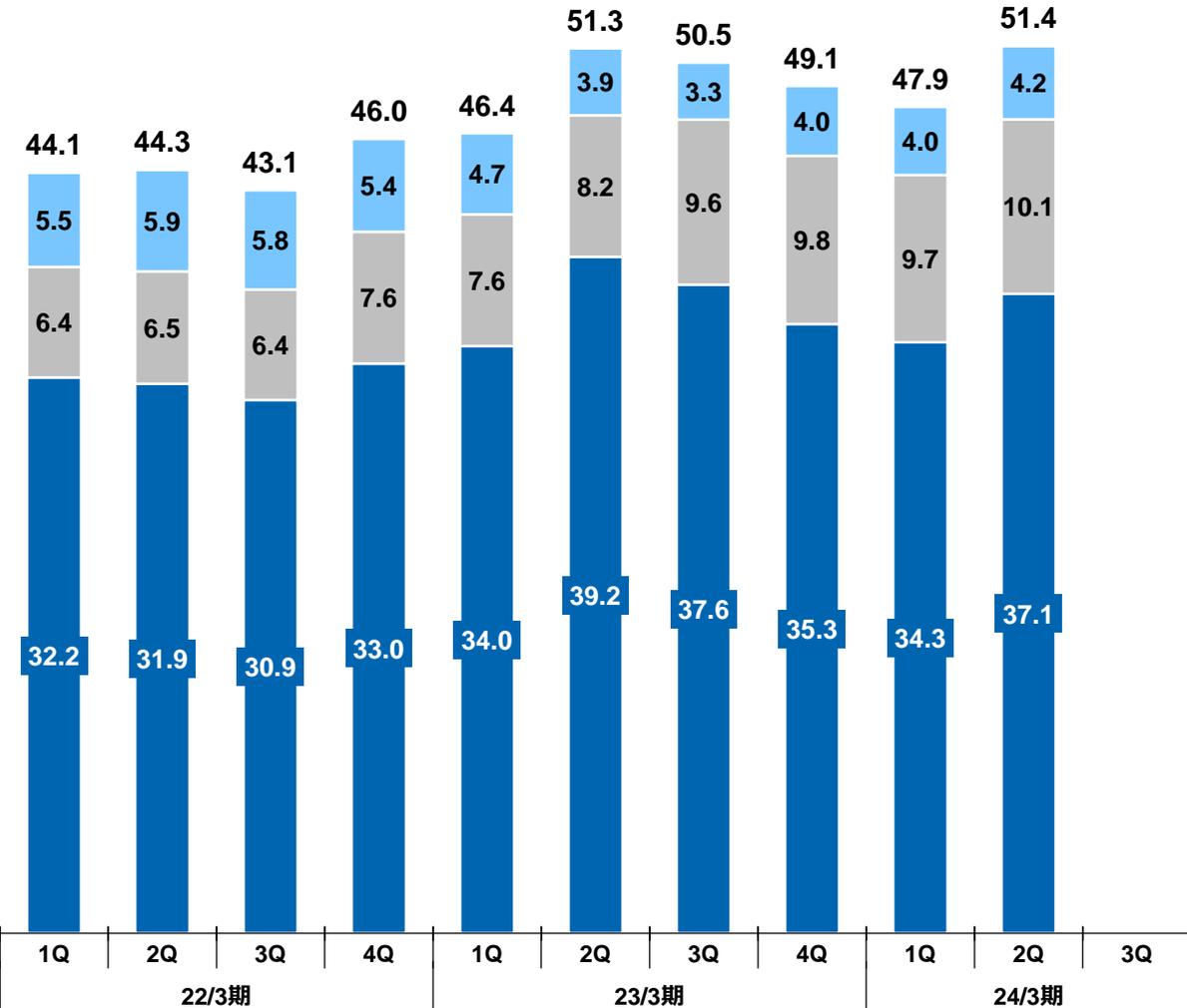
営業利益



プレジジョンテクノロジーズ セグメント (PT)

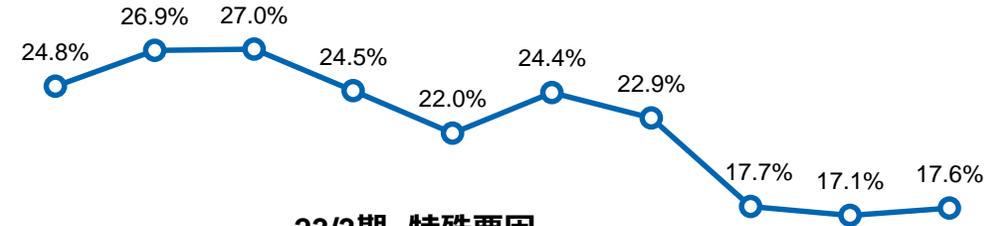
売上高 (10億円)

■ ボールベアリング ■ ロッドエンド・ファスナー ■ ピボットアッセンブリー



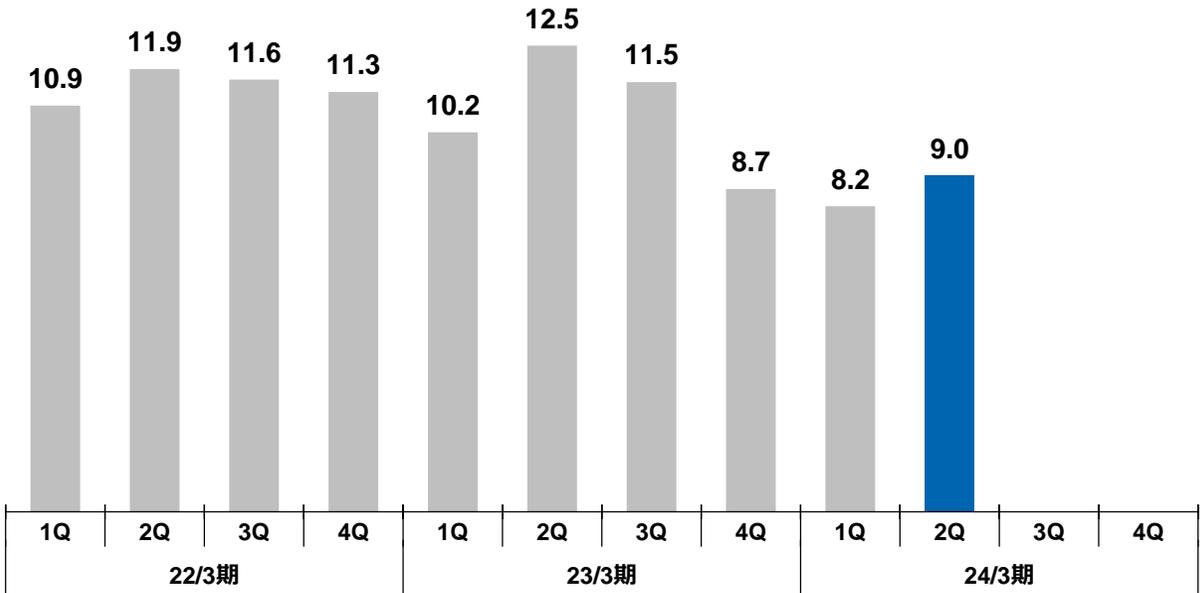
営業利益 (10億円)

■ 営業利益 ○ 営業利益率



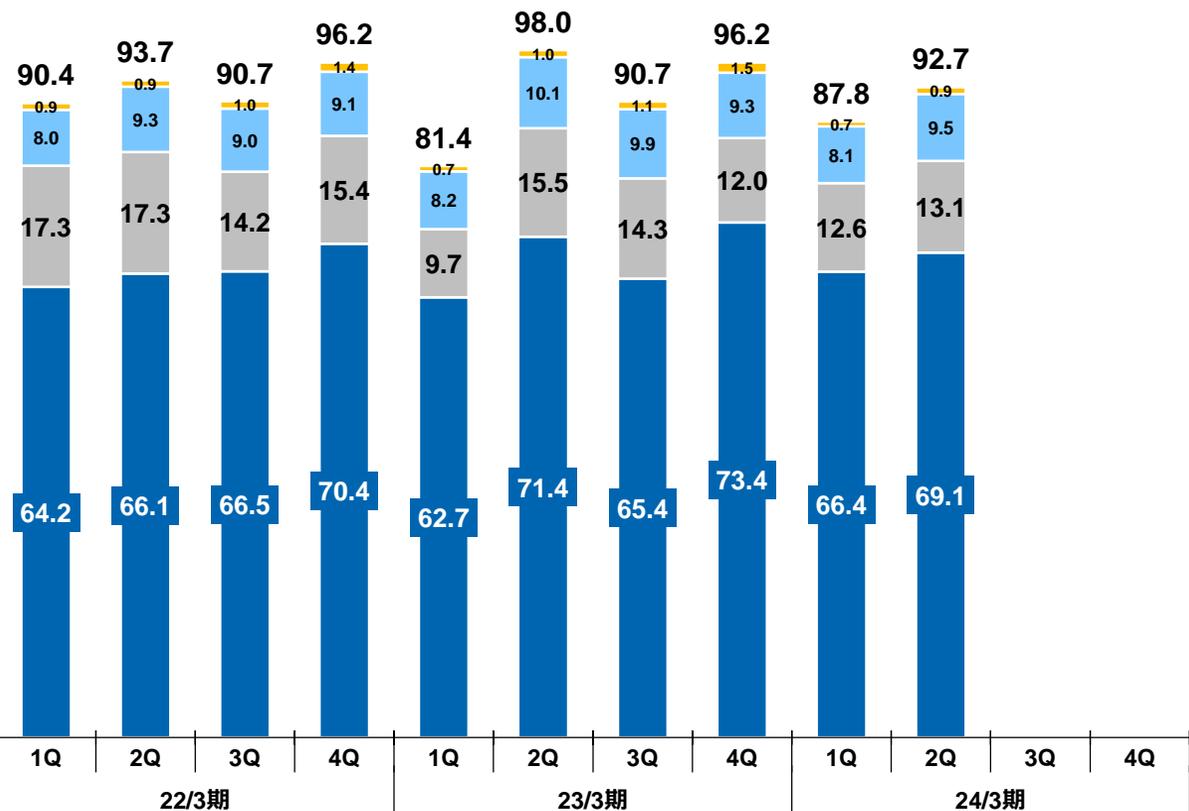
23/3期 特殊要因

	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
為替予約	△0.2	△0.3	△0.4	△0.2	△1.1
その他	-	-	-	△1.4	△1.4
合計	△0.2	△0.3	△0.4	△1.5	△2.4

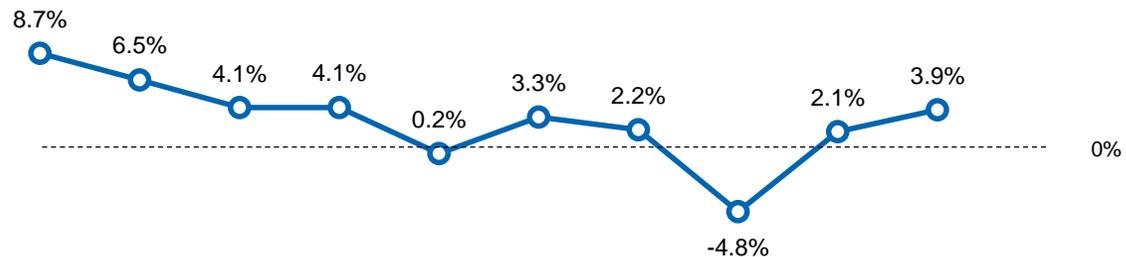


モーター・ライティング&センシング セグメント (MLS)

売上高 (10億円)

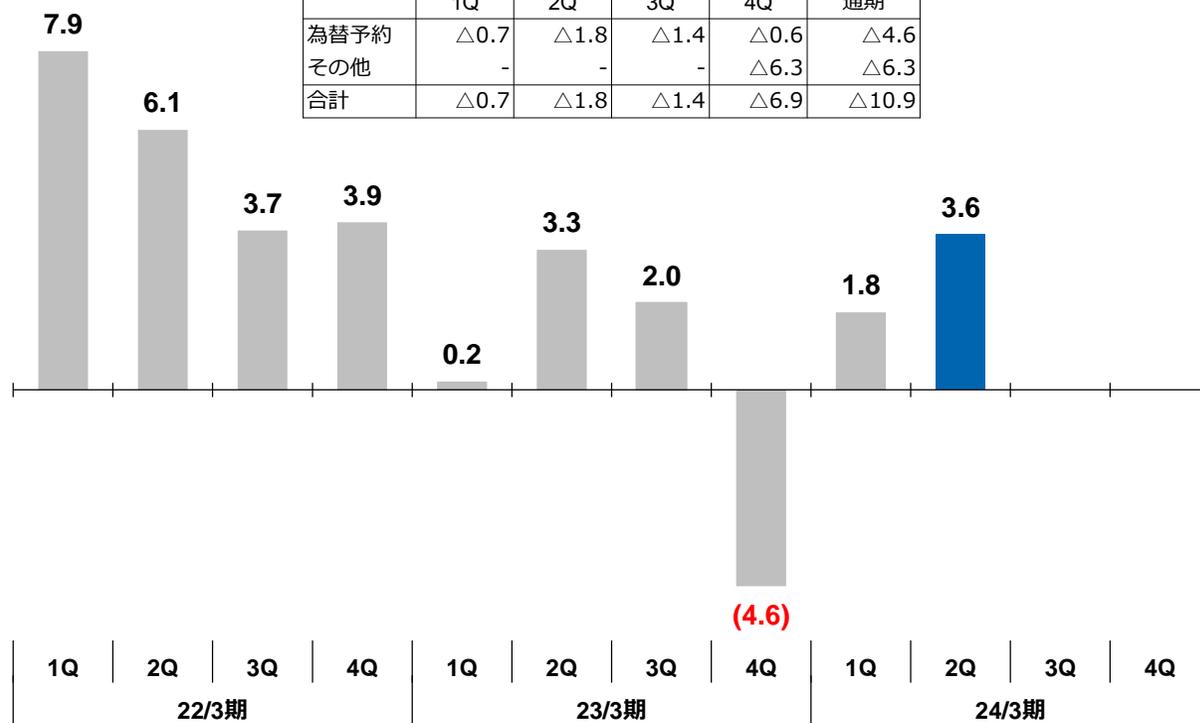


営業利益 (10億円)



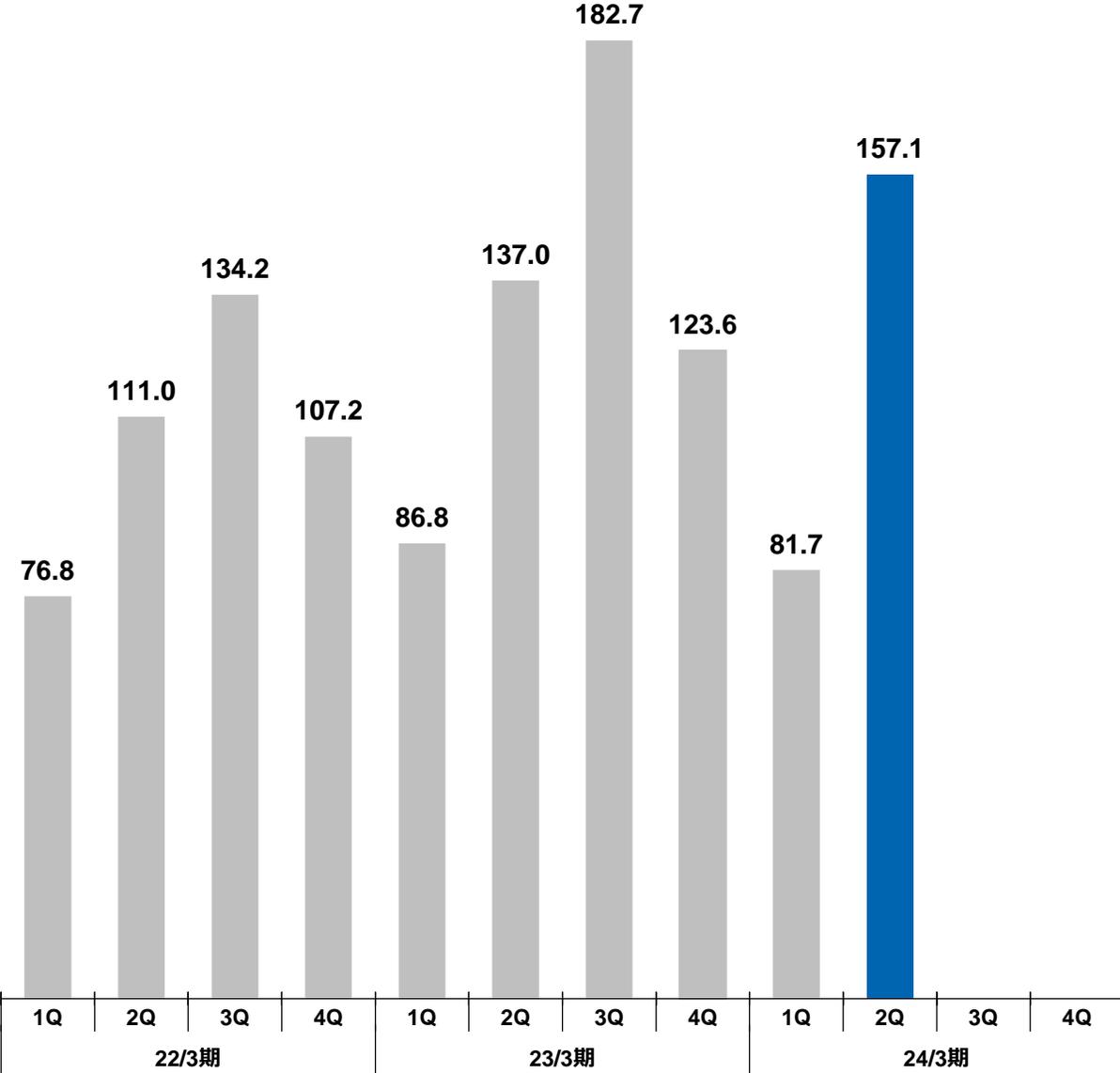
23/3期 特殊要因

	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
為替予約	△0.7	△1.8	△1.4	△0.6	△4.6
その他	-	-	-	△6.3	△6.3
合計	△0.7	△1.8	△1.4	△6.9	△10.9

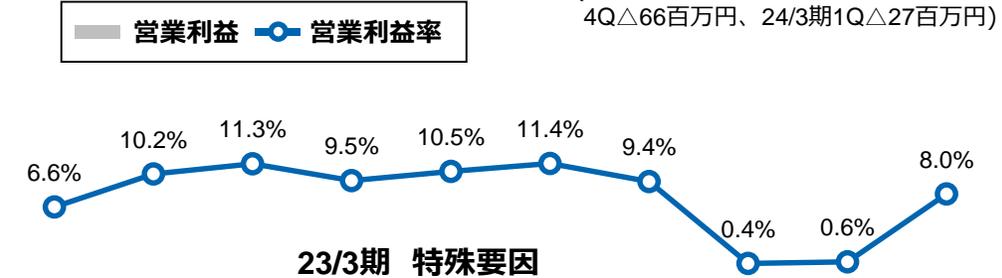


セミコンダクタ&エレクトロニクス セグメント (SE)

売上高 (10億円)



営業利益 (10億円)



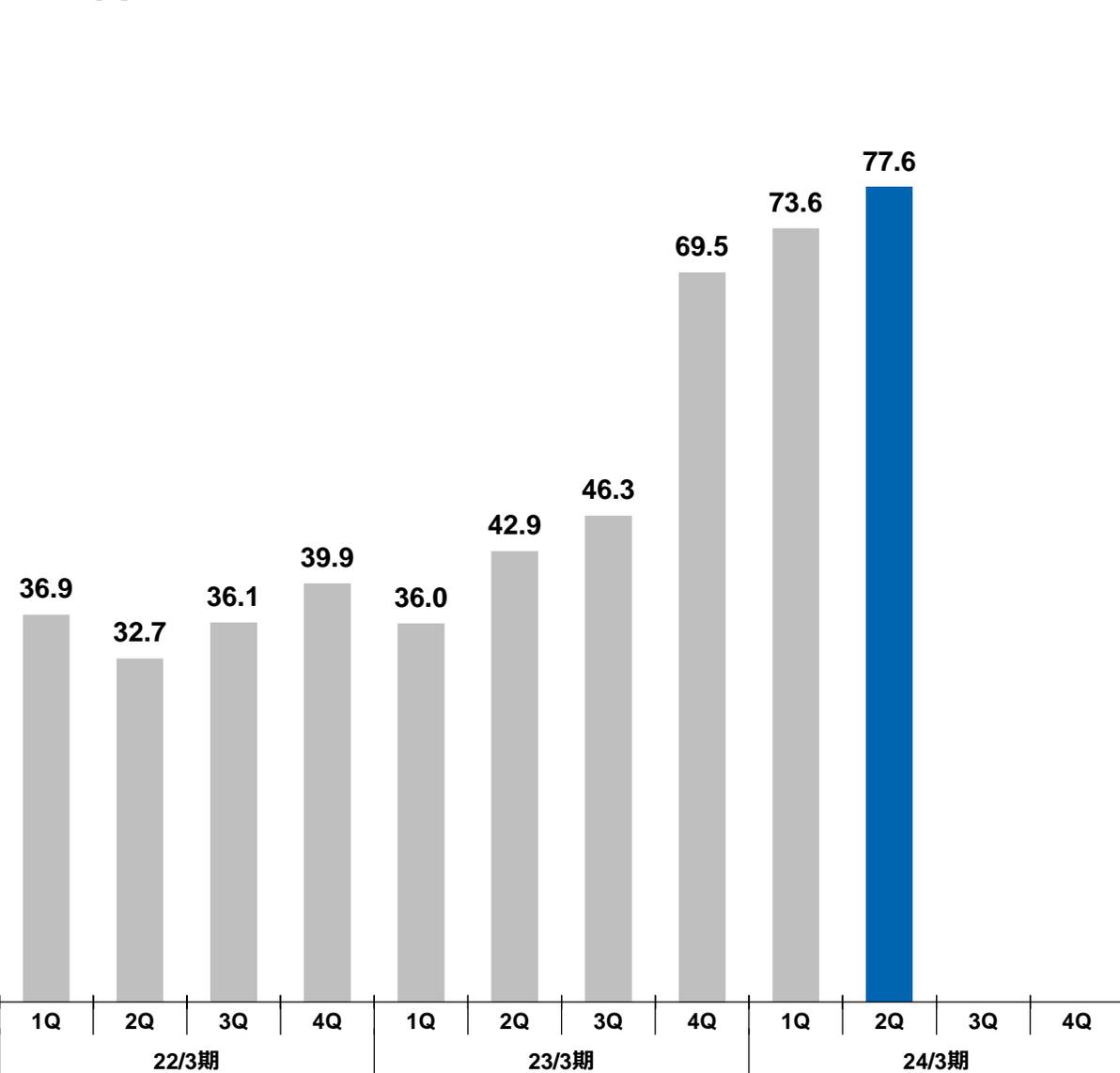
*本多通信工業のPPA評価完了に伴い、営業利益を遡及修正
(影響額は、23/3期2Q△63百万円、3Q△183百万円
4Q△66百万円、24/3期1Q△27百万円)

23/3期 特殊要因

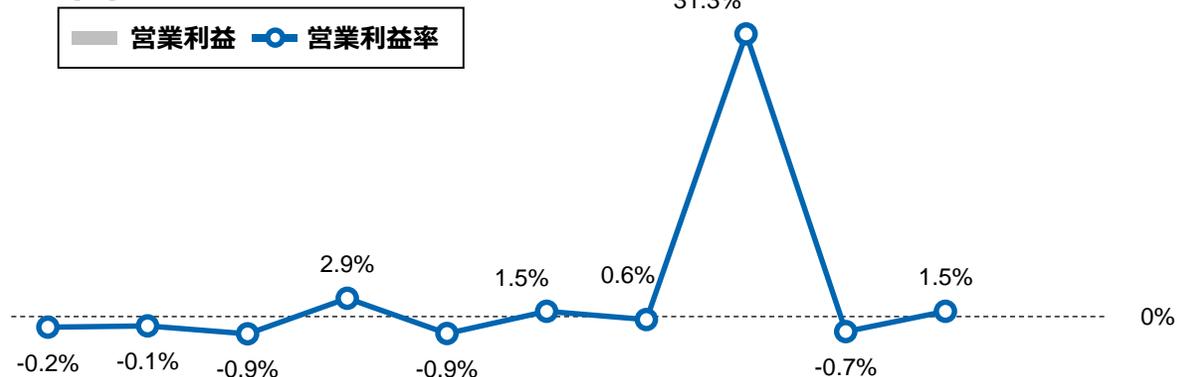
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
為替予約	△0.4	△0.8	△1.2	△0.7	△3.1
その他	-	-	1.7	△3.7	△2.0
合計	△0.4	△0.8	0.5	△4.4	△5.1

アクセスソリューションズ セグメント (AS)

売上高 (10億円)

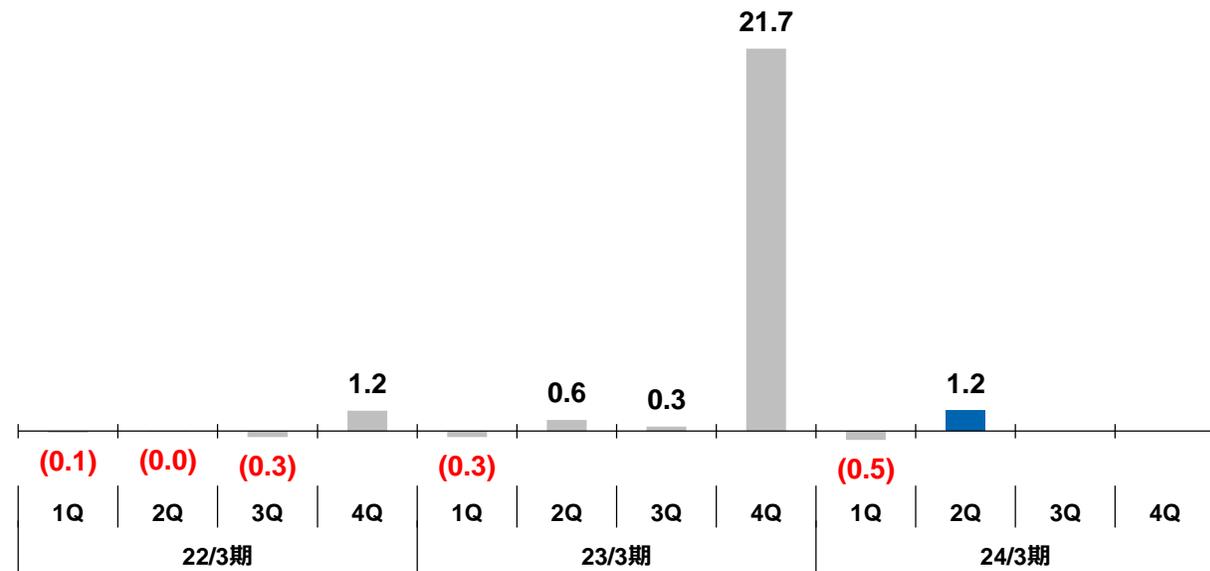


営業利益 (10億円)



23/3期 特殊要因

	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
為替予約	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	20.2	20.2
合計	-	-	-	20.2	20.2



親会社の所有者に帰属する四半期利益

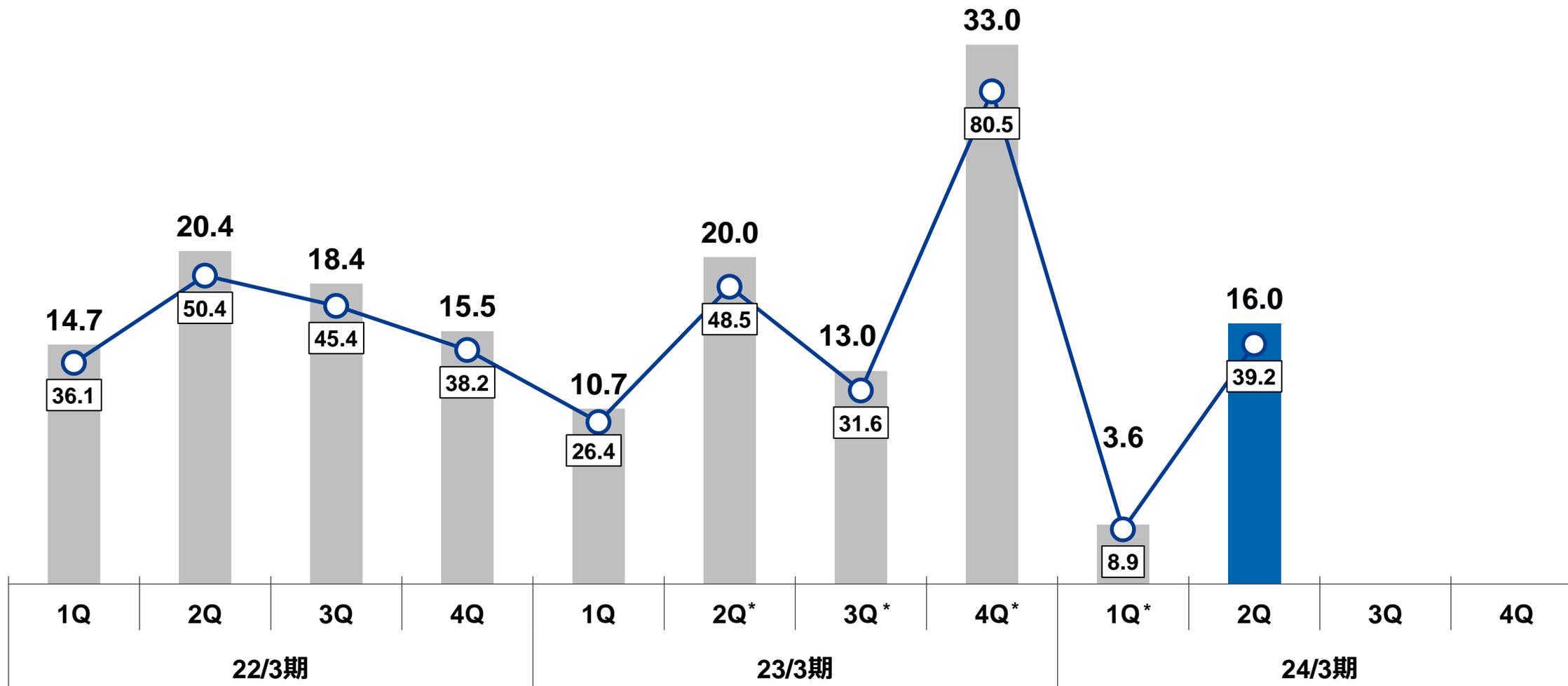
(10億円)

■ 親会社の所有者に帰属する四半期利益 ○ 基本的1株当たり四半期利益 (円)

*本多通信工業のPPA評価完了に伴い、遡及修正

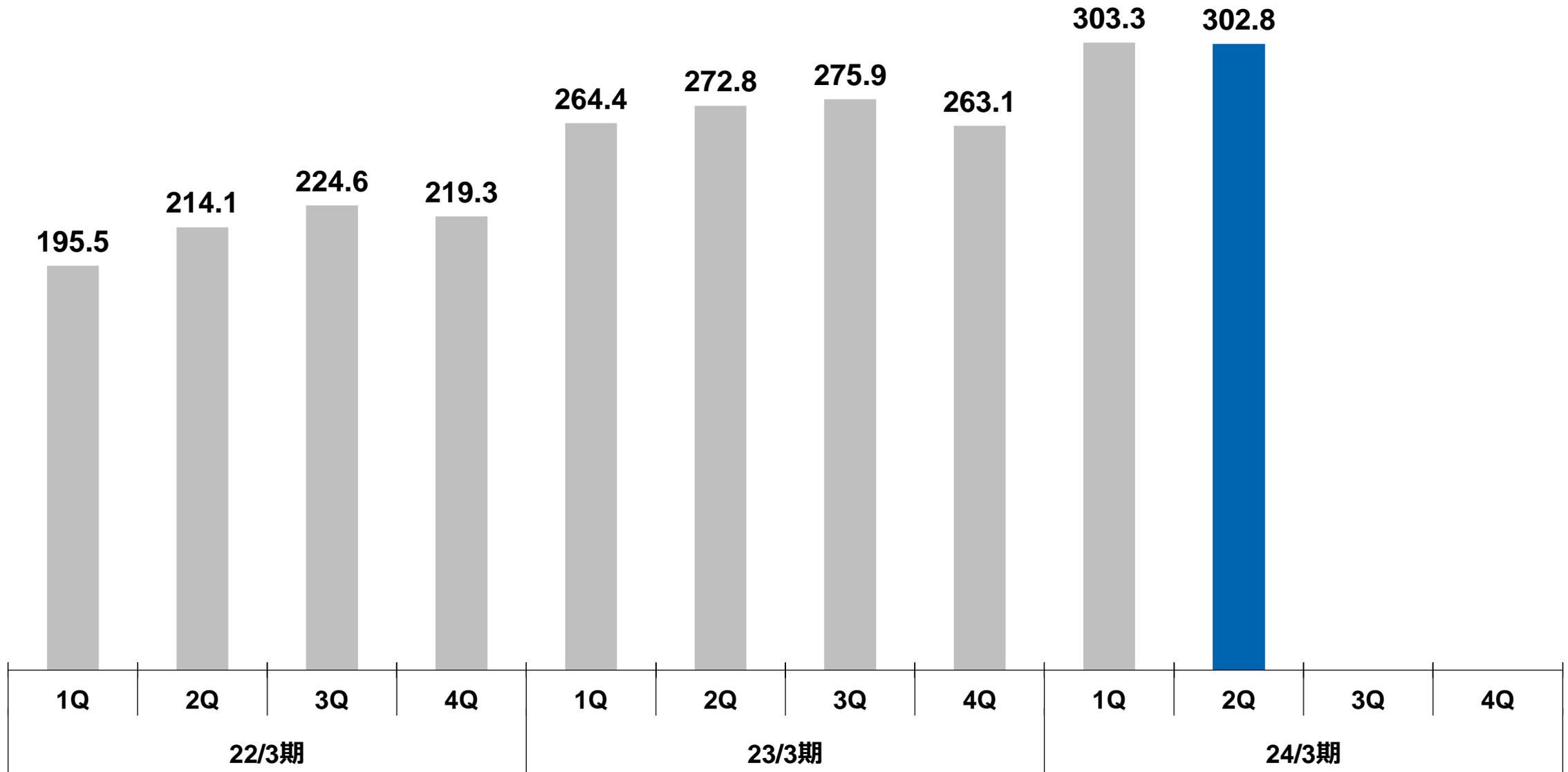
(影響額は、①親会社の所有者に帰属する四半期利益: 23/3期2Q△38百万円、3Q△110百万、4Q△44百万円、24/3期1Q△19百万円

②基本的1株当たり四半期利益: 23/3期2Q△0.09円、3Q△0.26円、4Q△0.11円、24/3期1Q△0.05円)



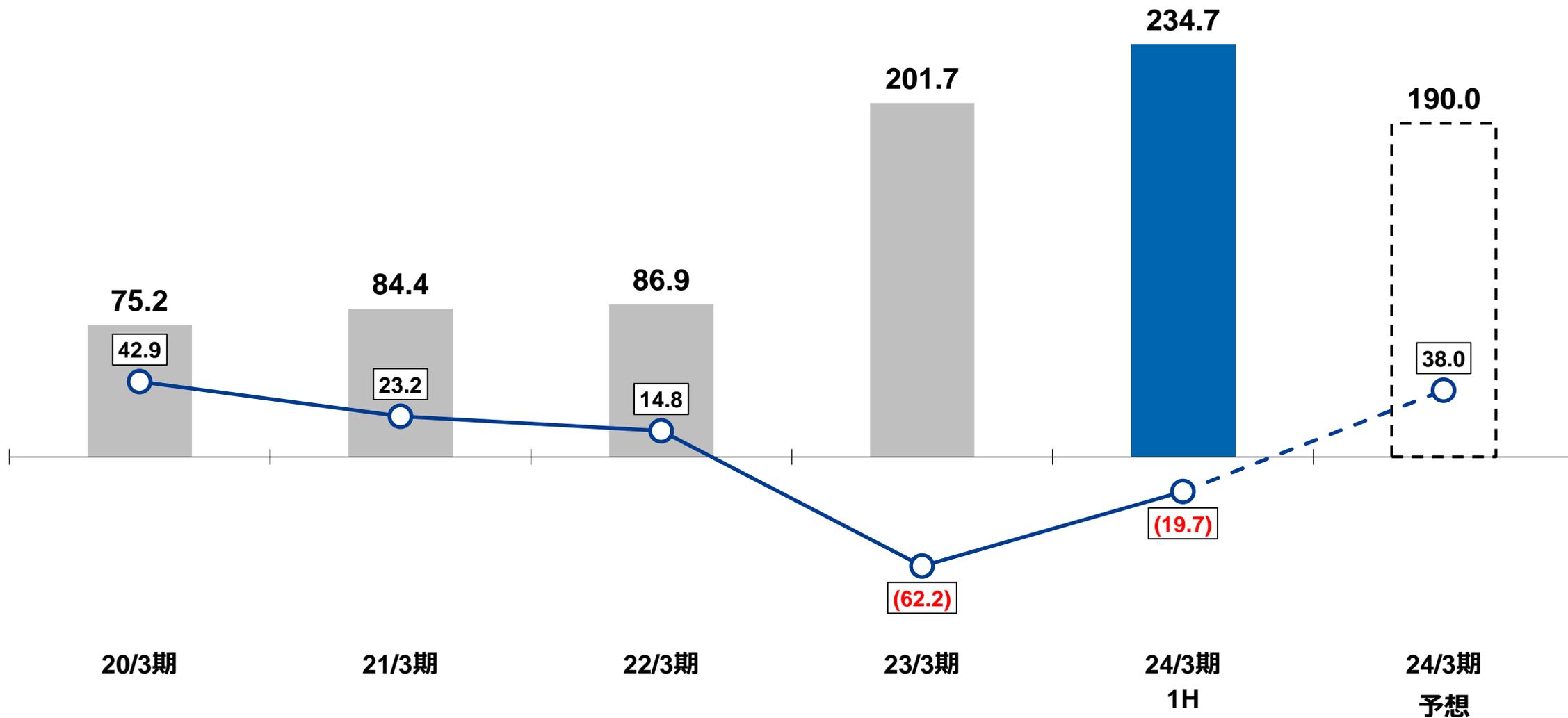
棚卸資産

(10億円)



ネット有利子負債、フリーキャッシュフロー

(10億円) ■ ネット有利子負債* ○ フリーキャッシュフロー



*ネット有利子負債：連結財政状態計算書上の「社債および借入金」 - 「現金および現金同等物」+ 3か月超の定期預金

通期業績予想を修正

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期			
	通期	上半期	下半期	通期	前期比
売上高	1,292,203	672,117	727,883	1,400,000	+8.3%
営業利益	101,210	27,162	49,838	77,000	-23.9%
税引前利益	95,808	30,201	47,799	78,000	-18.6%
親会社の所有者に帰属する 当期利益	76,818	19,600	38,400	58,000	-24.5%
基本的1株当たり 当期利益 (円)	187.16	48.06	94.42	142.48	-23.9%

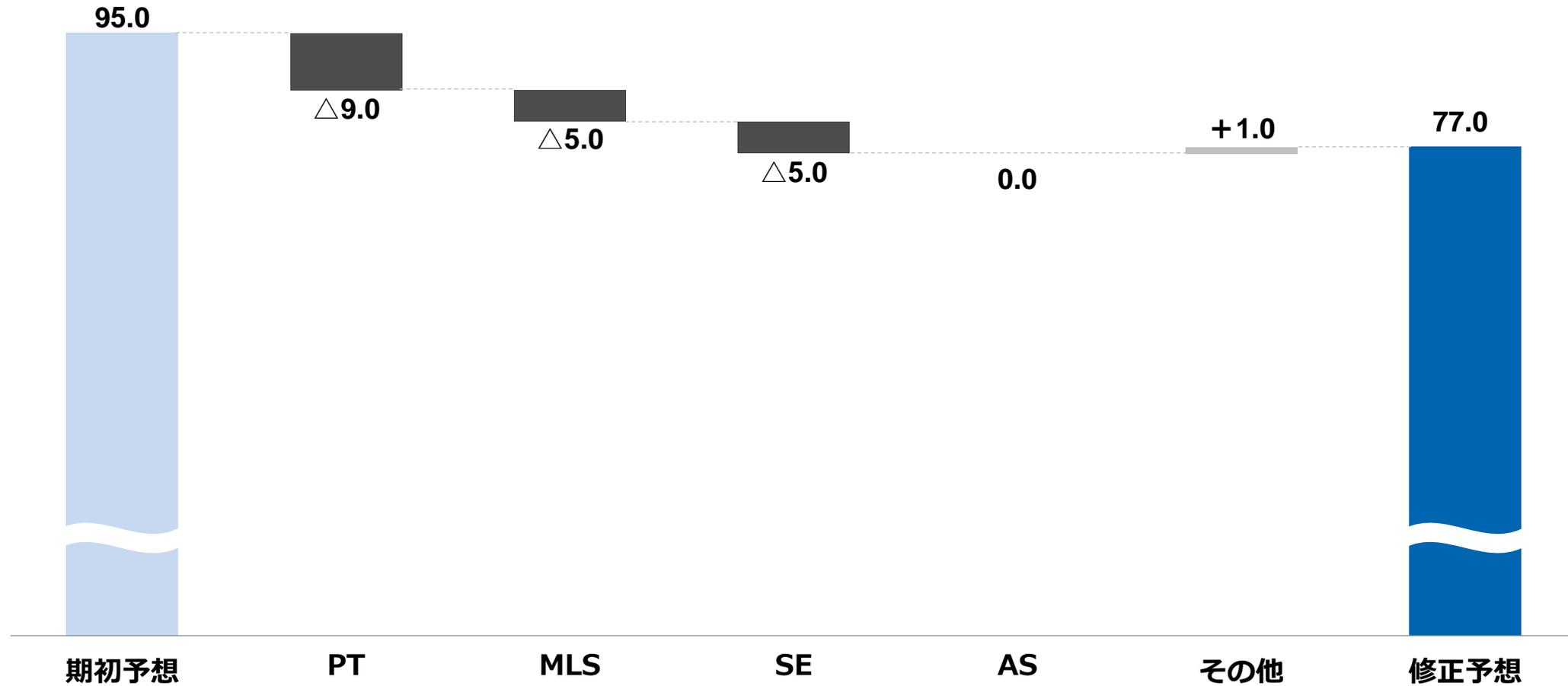
為替レート	2023年3月期 通期	2024年3月期 下半期想定
US\$	134.19円	140.00円
ユーロ	139.90円	155.00円
タイバーツ	3.82円	4.05円
人民元	19.68円	19.50円

セグメント別業績予想

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期			
	通期	上半期	下半期	通期	前期比
売上高	1,292,203	672,117	727,883	1,400,000	+8.3%
プレジジョンテクノロジーズ	197,300	99,361	105,639	205,000	+3.9%
モーター・ライティング&センシング	366,275	180,469	189,531	370,000	+1.0%
セミコンダクタ&エレクトロニクス	530,079	238,803	261,197	500,000	-5.7%
アクセスソリューションズ	194,699	151,217	168,783	320,000	+64.4%
その他	3,850	2,267	2,733	5,000	+29.9%
営業利益	101,210	27,162	49,838	77,000	-23.9%
プレジジョンテクノロジーズ	42,951	17,250	22,750	40,000	-6.9%
モーター・ライティング&センシング	922	5,445	6,555	12,000	13.0倍
セミコンダクタ&エレクトロニクス	42,383	13,094	23,906	37,000	-12.7%
アクセスソリューションズ	22,302	660	9,340	10,000	-55.2%
その他	△48	△194	△806	△1,000	-
調整額	△7,300	△9,093	△11,907	△21,000	-

通期営業利益 期初予想との差

(10億円)



事業概況と経営戦略

Management policy & Business strategy

2023年11月2日

代表取締役 会長 CEO

貝沼 由久



全体

- 上半期の売上高・営業利益は、ほぼ想定通りの着地。
- 2024年3月期通期の業績予想は、データセンター等の回復遅れが主要因となり下方修正。ただし、全体市場はボトムアウトの兆しあり。
- アクセスソリューションズは上半期黒字化達成。通期営業利益100億円達成見込み。
- 収益源の回復と製品市場の多様化で新たな収益源創出により中長期的な事業拡大計画は不変。

プレジジョン テクノロジーズ (PT)

- 自動車向け、航空機向けはさらに回復するもデータセンターの回復待ち。
- 新たな機械加工ビジネスの拡大が進む。
- ピボットは非HDDアプリケーションが成長。

モーター・ライティング& センシング (MLS)

- モーターは用途ごとに凸凹あるも、車載向けは、市場回復とコンテンツグロースで拡大継続。
- バックライトは、車載・タブレット向けビジネスで収益確保。

セミコンダクタ& エレクトロニクス (SE)

- アナログ半導体は緩やかに回復。
- 日立パワーデバイスを取得しパワー半導体事業を強化。売上高2,000億円早期実現へ。
- 光デバイスは2Q生産好調。今後も拡大を期待。

アクセスソリューションズ (AS)

- PMI活動、構造改革による収益力の改善により、今期営業利益100億円達成見込。相合によりさらに成長を加速する。

通期営業利益予想は770億円とする 短期的には市場減速の影響を受けるが、中長期的には着実に成長

今期の ポイント	PT	データセンターの回復遅れ続くも、更なる生産性改善に注力。
	MLS	非車載モーターを中心に苦戦するも、車載向けビジネスは回復途上。
	SE	光デバイスは1Q減速響くも2Q以降堅調。半導体は緩やかに回復。
	AS	欧州黒字化の達成と、通期100億円営業利益達成見込み。

(百万円)	2023年3月期	2024年3月期			
	通期	上半期	下半期	通期	前期比
売上高	1,292,203	672,117	727,883	1,400,000	+8.3%
営業利益	101,210	27,162	49,838	77,000	-23.9%
<small>親会社の所有者に帰属する</small> 当期利益	76,818	19,600	38,400	58,000	-24.5%
<small>基本的1株あたり</small> 当期利益(円)	187.16	48.06	94.42	142.48	-23.9%

株式会社日立パワーデバイスの概要



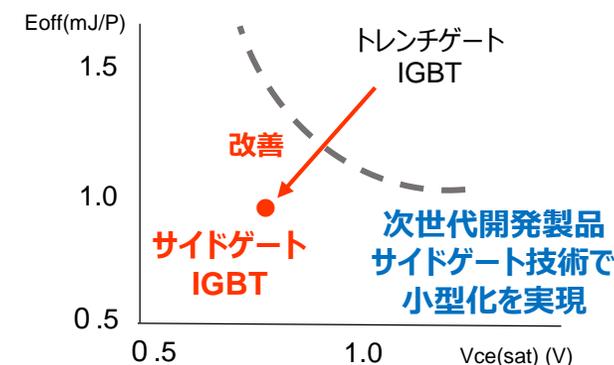
名称	株式会社日立パワーデバイス
所在地	茨城県日立市大みか町五丁目2番2号
代表者の役職・氏名	取締役社長 鈴木 雅彦
事業内容	半導体部品の設計、製造及び販売 半導体応用機器と部品の設計、製造及び販売
資本金	450百万円
設立年月日	2013年10月1日
大株主及び持株比率	株式会社日立製作所 100%

両社パワー半導体の「強み」を融合し、「垂直統合型のパワー半導体事業」を強化・拡大

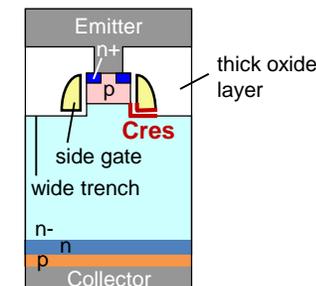


統合によるシナジー

1. 従前より当社は日立パワーデバイスの前工程のFabとして製造受託しており、垂直統合で統合初日より付加価値を取り込める。
2. 従来トレンチゲートIGBTに対して遥かな高性能を実現できるサイドゲートIGBTは、既に滋賀工場で作中。来期より市場に投入、グローバルニッチトップを追求できる。
3. パワー系の開発技術者の人員増強。SiCの技術者の獲得。
(ミツミ150名、エイブリック100名、日立パワーデバイス150名 = 400名)
4. 日立パワーデバイスが元々保有している後工程の能力を獲得し、後工程強化の土台獲得。
5. ミネベアミツミになかった後工程パッケージ、モジュール技術を手入。
6. 輸送機器（電鉄）、パワーグリッドなど高耐圧品等、幅広い市場へ製品展開。



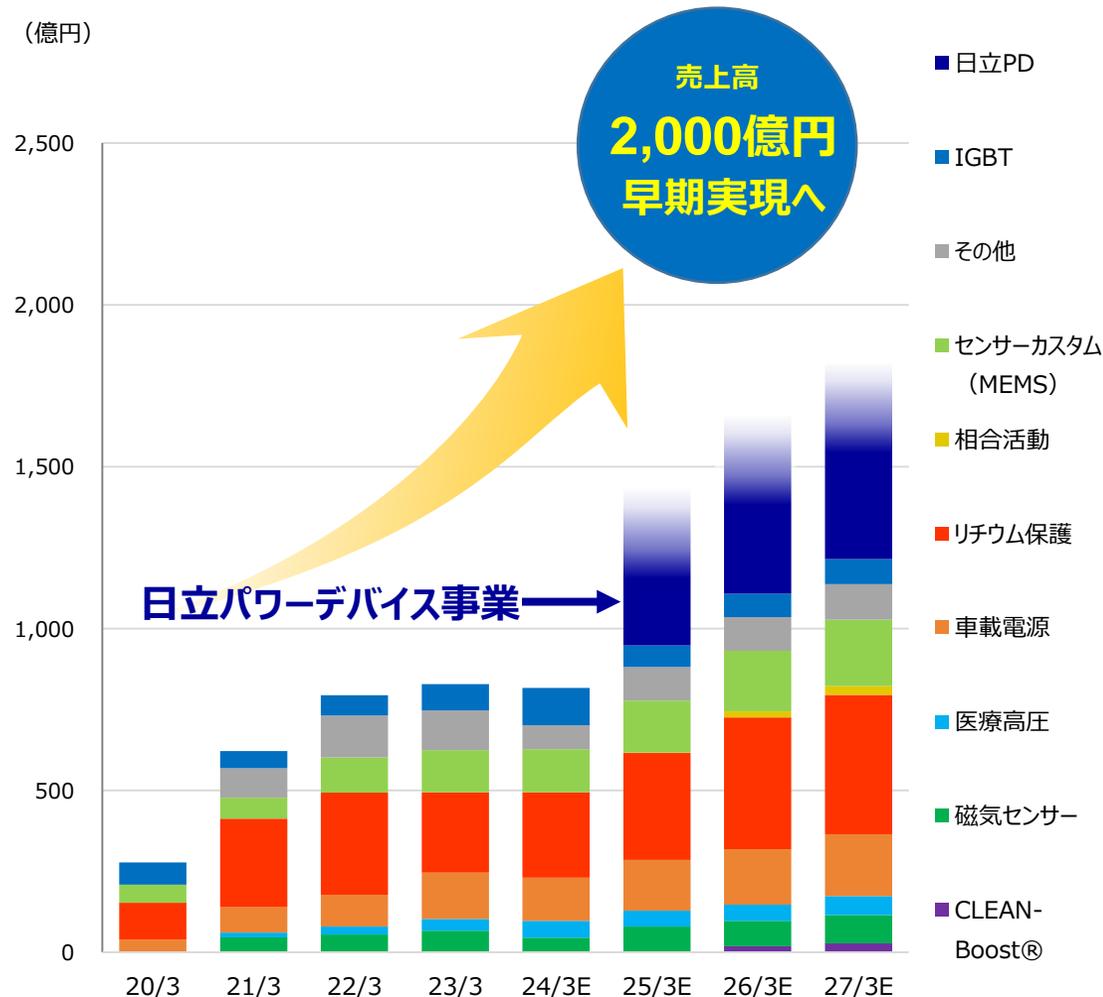
サイドゲート構造 (TX, VXシリーズ)



グローバルニッチトップと相乗効果で更に拡大

	半導体8本槍	ターゲット	KSF/特徴	注力製品	
ミツミ半導体事業部	パワー半導体	IGBT/SiC	EV/産機 輸送機器 パワーグリッド	日立パワーデバイス <ul style="list-style-type: none"> ● モジュール技術 	<ul style="list-style-type: none"> ● IGBT/SiC(パッケージ) ● 高圧IC・パワーグリッド ● ダイオード
		アナログ半導体	センサー カスタム	カスタム MEMS	<ul style="list-style-type: none"> ● チップ関連技術 ● 生産ライン拡大 ● プロセス技術 ● コストダウン手法 ● サプライチェーン
	相合活動	クロステック			
	リチウム保護	EV/ESS			
	エイブリック事業部	車載電源	ADAS カメラ xEV	<ul style="list-style-type: none"> ● プロセス技術 ● すり合わせ技術 ● 共創 ● ソリューション ● エンジニア ● 外部FAB(微細化) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池保護 ● 電源(DC/DC、LDO) ● センサー ● MEMS&AFE ● 多セル(2~18直) ● 車載(EV) ● 医療(家庭用) ● 相合
		医療高圧	超音波診断 非破壊検査ソナー		
		磁気センサー	モビリティ ロボティックス		
		CLEAN-Boost®	SDGs		

半導体部門 売上計画イメージ (日立パワーデバイス取得後の想定値)



ターンアラウンド実現へ通期営業利益100億円超が見えてきた

主なポイント

- 1 PMI、構造改革の成果が結実
- 2 Tier1ポジションのフル活用
自動車生産台数の回復に伴い引合・受注は大きく拡大
- 3 社会課題解決に貢献する新製品開発

開発品：UWB技術による「幼児置き去り検知システム」

UWB（超広帯域無線）を用いて、物体検知と高精度な測距機能を組み合わせたソリューションを活用。
幼児の呼吸によるわずかな体の動きを検出し、置き去りを警告。

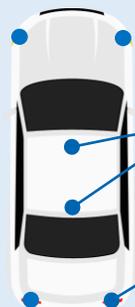


UWBレーダー
(幼児置き去り検知)

UWB通信
(デジタルキー)

+

アクセス製品
(ラッチ、パワーアクチュエーター、ハンドルetc.)



デジタルキー
置き去り検知
共有アンカー

デジタルキー
専用アンカー



■ AS営業利益 ○ AS営業利益率 ※23/3期は特殊要因を除いた数字

24/3期 通期営業利益予想比

市場回復時点のイメージ

ベアリング

(航空機関連含む)

データセンター市場等の回復

+ 130~170億円

モーター

スピンドル及び非車載モーター等の回復

+ 90~110 億円

アクセス

自動車市場完全回復 + PMI効果

+ 90~110 億円

半導体

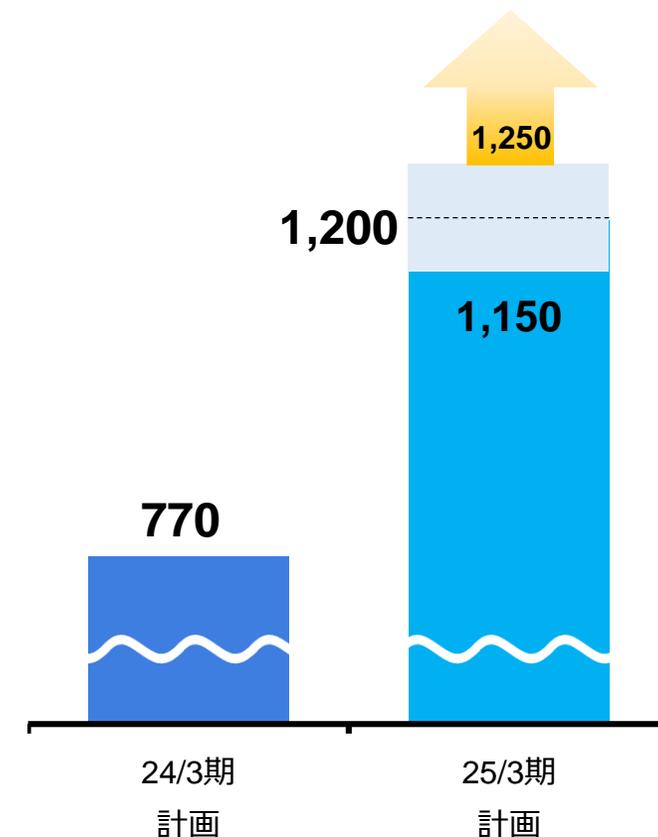
市況回復 + 滋賀工場 黒字化
+ 日立パワーデバイス等

+ 70~90 億円

合計

+ 380~480 億円

営業利益のイメージ (億円)



上記に加えた更なる上振れ要因

車載モーター・車載バックライト

データ生成量

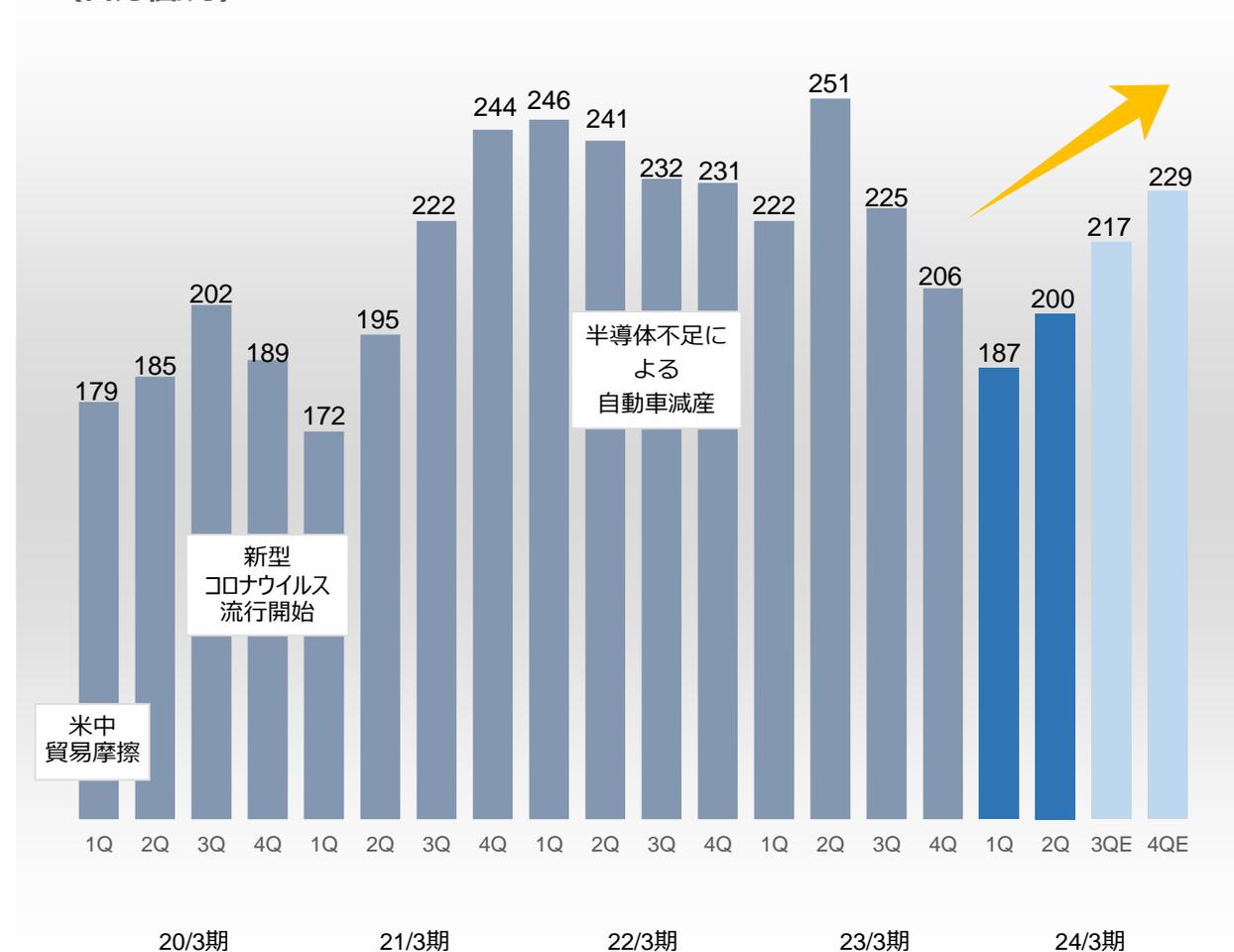
- データセンター市場のボトムアウトが近い。
- データ生成量は確実に拡大していく。
(CY22-CY27 CAGR20%超)

ボールベアリング、ピボット、スピンドル

- データセンター市場のボトムアウトの兆しあり。
ボールベアリング外販数量は1Q 187百万個を底に
2Qは200百万個まで回復。
- **長期的にはサイクルはあるものの、
トップ・ボトムのレンジは上昇傾向。**
- ピボット、スピンドルも回復を見込む。

ボールベアリング外販数量

(百万個/月)



カーボンニュートラルへの取り組みを推進

セブ工場（大規模電力消費拠点）大規模太陽光発電システム設置および電力調達契約を締結

1 太陽光発電

- フィリピンの日系工場で最大級の発電能力（起電力7.9MW）*の自家発電設備に投資し、2023年10月稼働開始。
これにより6,833トン/年のCO₂排出量削減を達成。

* 2023年10月19日時点（ミネベアミツミ調べ）

2 電力調達契約（PPA）

- 自家発電に加えて、再生可能エネルギー電力調達契約を締結。
2024年2月には100%再生可能エネルギー使用工場へ。
- **大手携帯電話向けにはカーボンニュートラル達成**

統合報告2023を発行

成長戦略をメインテーマに、次世代にむけた新経営体制、サクセションを重点的に紹介するとともに、人的資本の記載を充実しています。

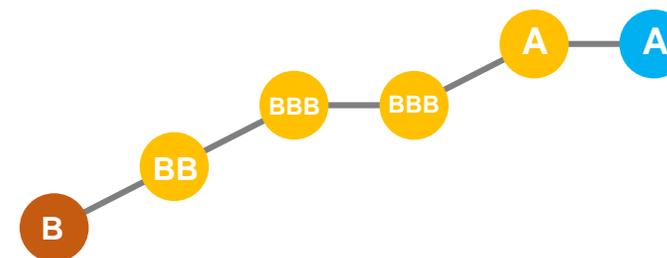
当社ウェブサイトでご覧下さい。→



MSCIのESG格付でA格を取得

ESG活動の推進、開示に継続的に取り組み、A格を維持しました。
今後もさらなる企業価値向上に向けて改善を続けてまいります。

Rating history



Jan-18 Jan-19 Jan-20 Feb-21 Sep-22 Sep-23

配当金

中間配当は前年水準を維持

24/3期 配当

中間配当	未定	→	20 円/株
期末配当 (予想)	未定	→	未定

期末配当は、当期の業績を勘案した上で決定の予定
 ただし、期末配当を20円とした場合、配当性向は28.1%、自己株式取得を含めた総還元性向は44.7%
 中長期的なキャッシュアロケーション方針は不変

(ご参考) 23/3期 配当 年間配当40円 (中間配当20円 期末配当20円)

自己株式の取得

2023年10月30日に開示したとおり、8月7日から10月27日まで(約定ベース)で
 以下のとおり自己株式の取得を実施終了いたしました

取得した株式の総数： 4,000,000株

取得価額の総額： 9,643,584,633円

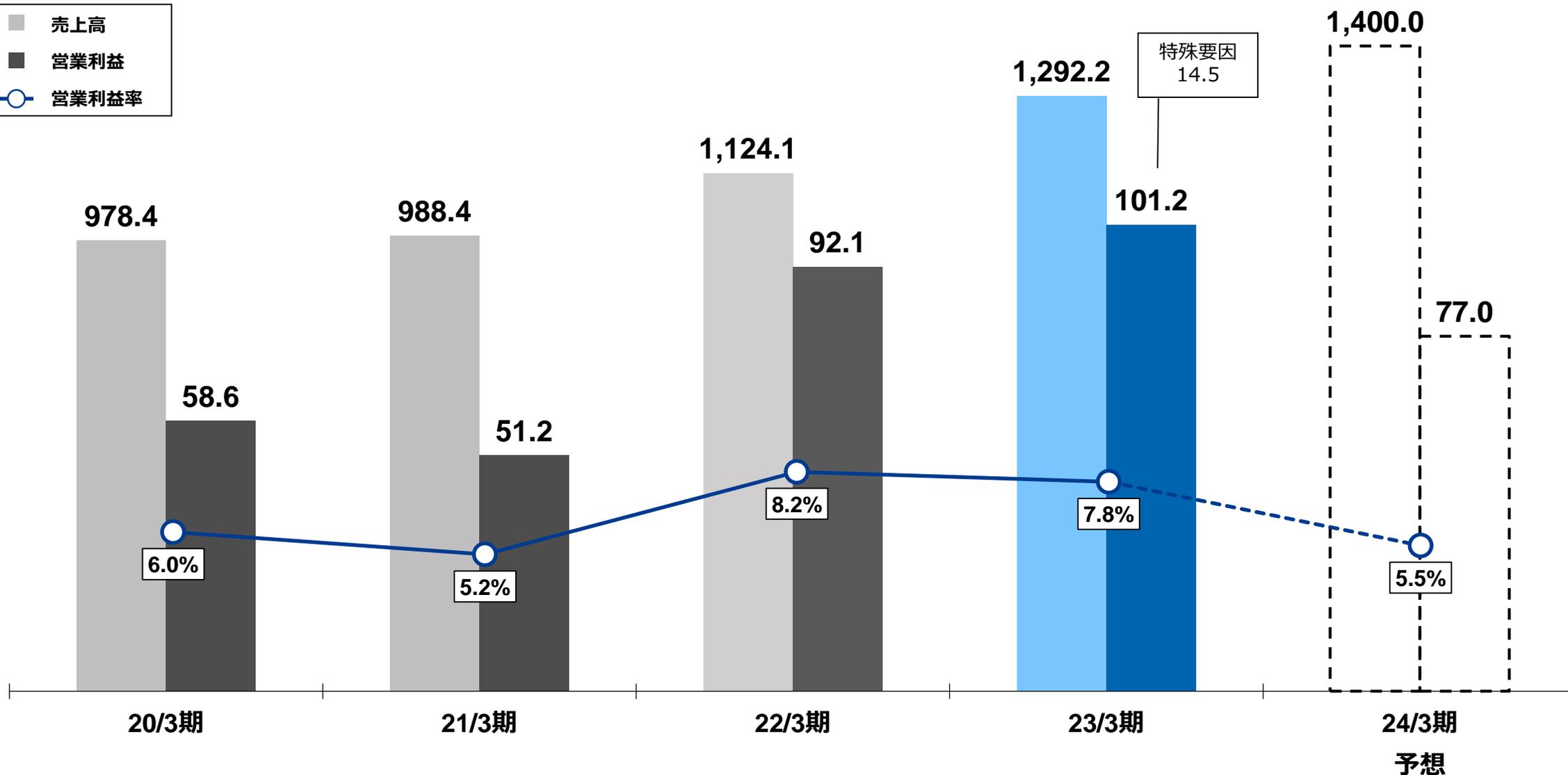


当資料で述べられた内容のうち歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、また、それらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづいております。実際の業績は、さまざまな要素により、これら見通しとは大きく異なる結果となる場合があります。実際の業績に影響を与える重要な要素としては、(1)当社を取り巻く経済情勢、需要動向等の変化、(2)為替レート、金利等の変動、(3)エレクトロニクスビジネス分野で顕著な急速な技術革新と継続的な新製品の導入の中で、タイムリーに設計・開発、製造・販売を続けていく能力、などです。但し、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。本資料に掲載のあらゆる情報はミネベアミツミ株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに複製・変更・転載・転送等を行わないようお願いいたします。

參考資料

売上高、営業利益、営業利益率

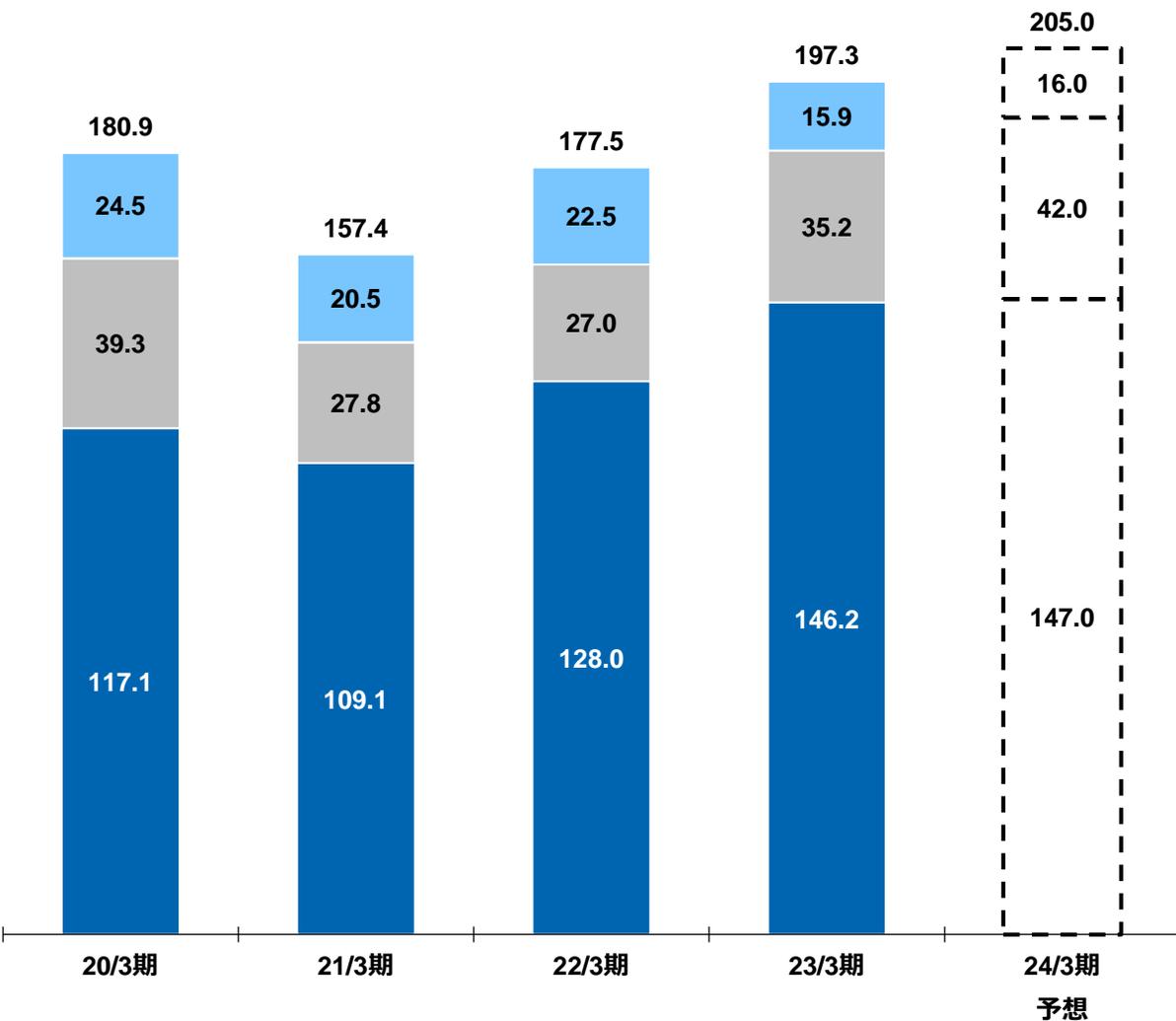
(10億円)



プレジジョンテクノロジーズ セグメント (PT)

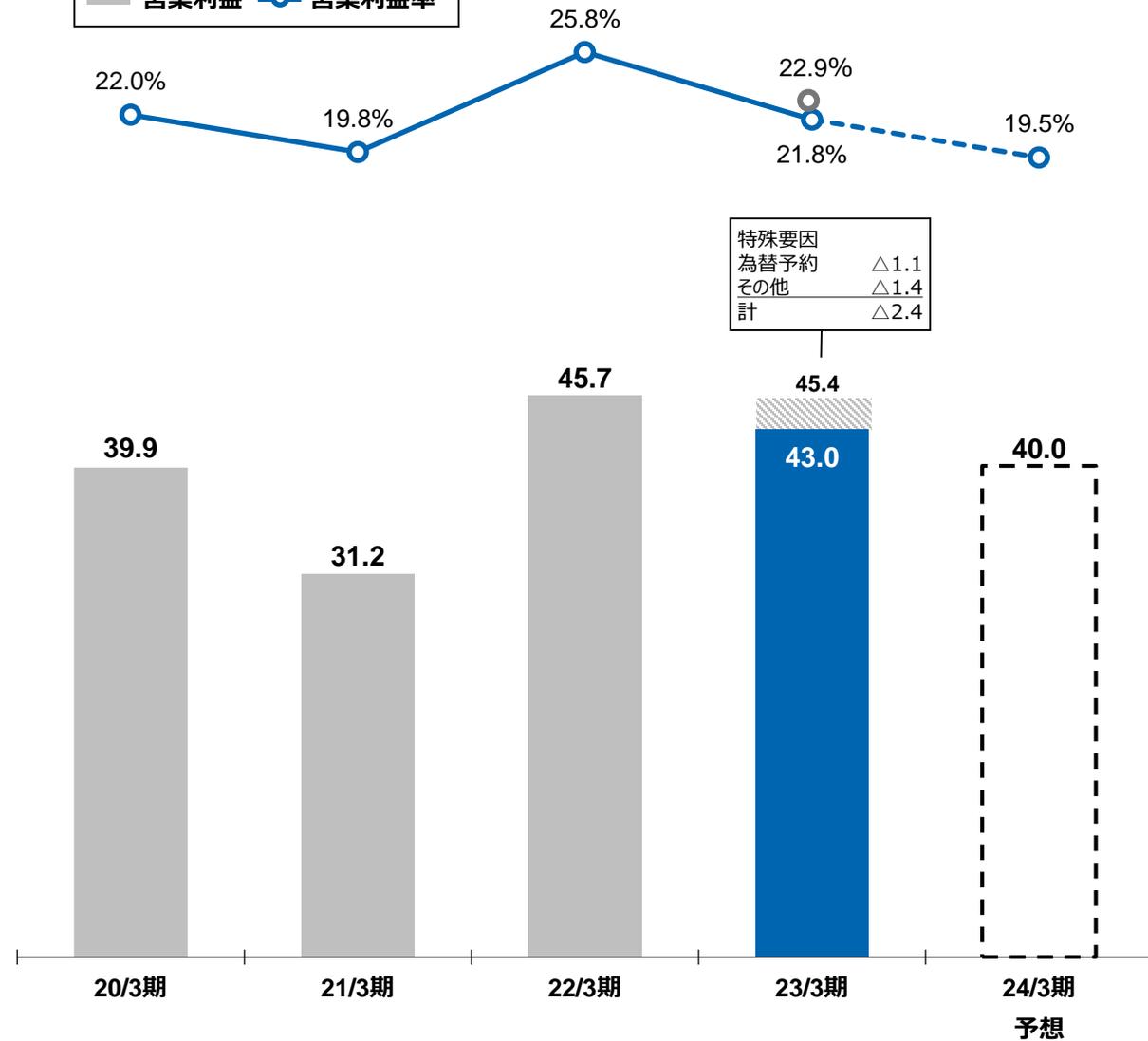
売上高 (10億円)

■ ボールベアリング ■ ロッドエンド・ファスナー ■ ピボットアッセンブリー



営業利益 (10億円)

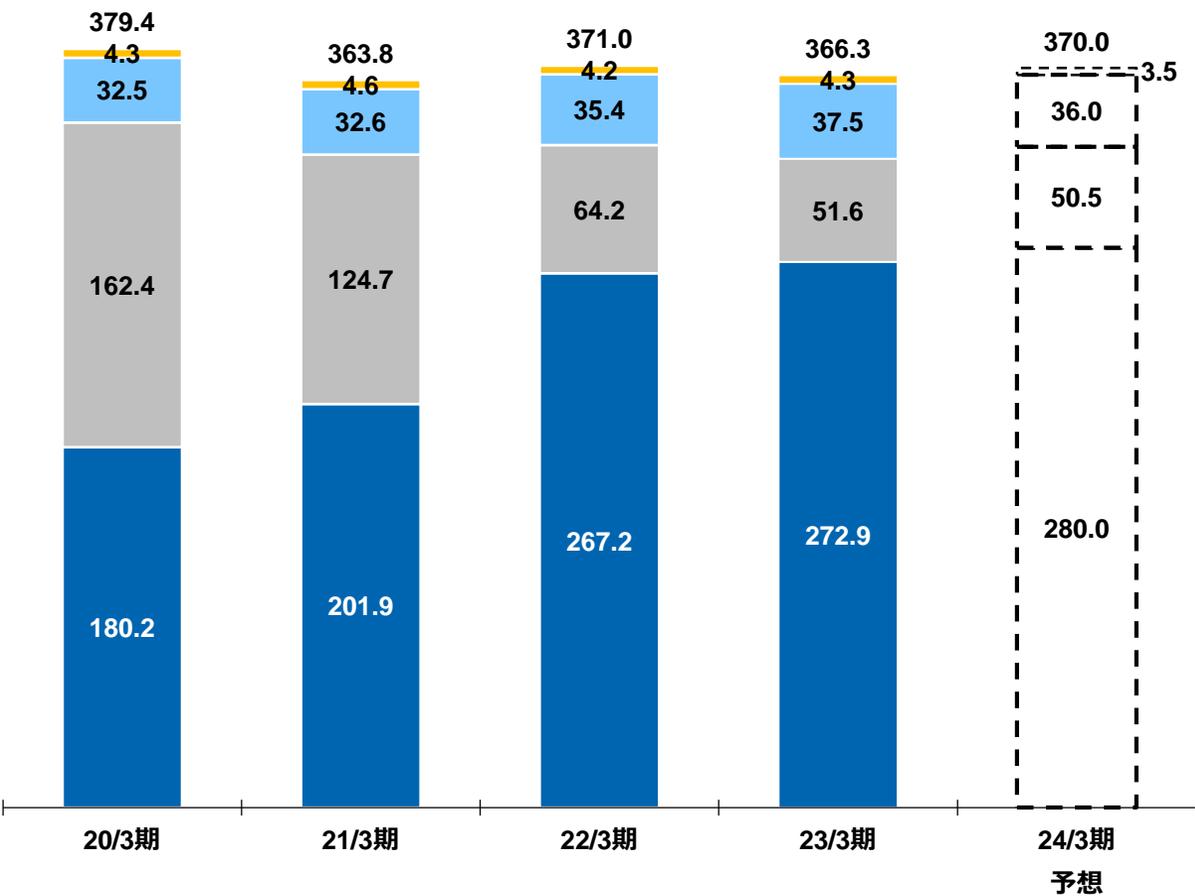
■ 営業利益 ○ 営業利益率



モーター・ライティング&センシング セグメント (MLS)

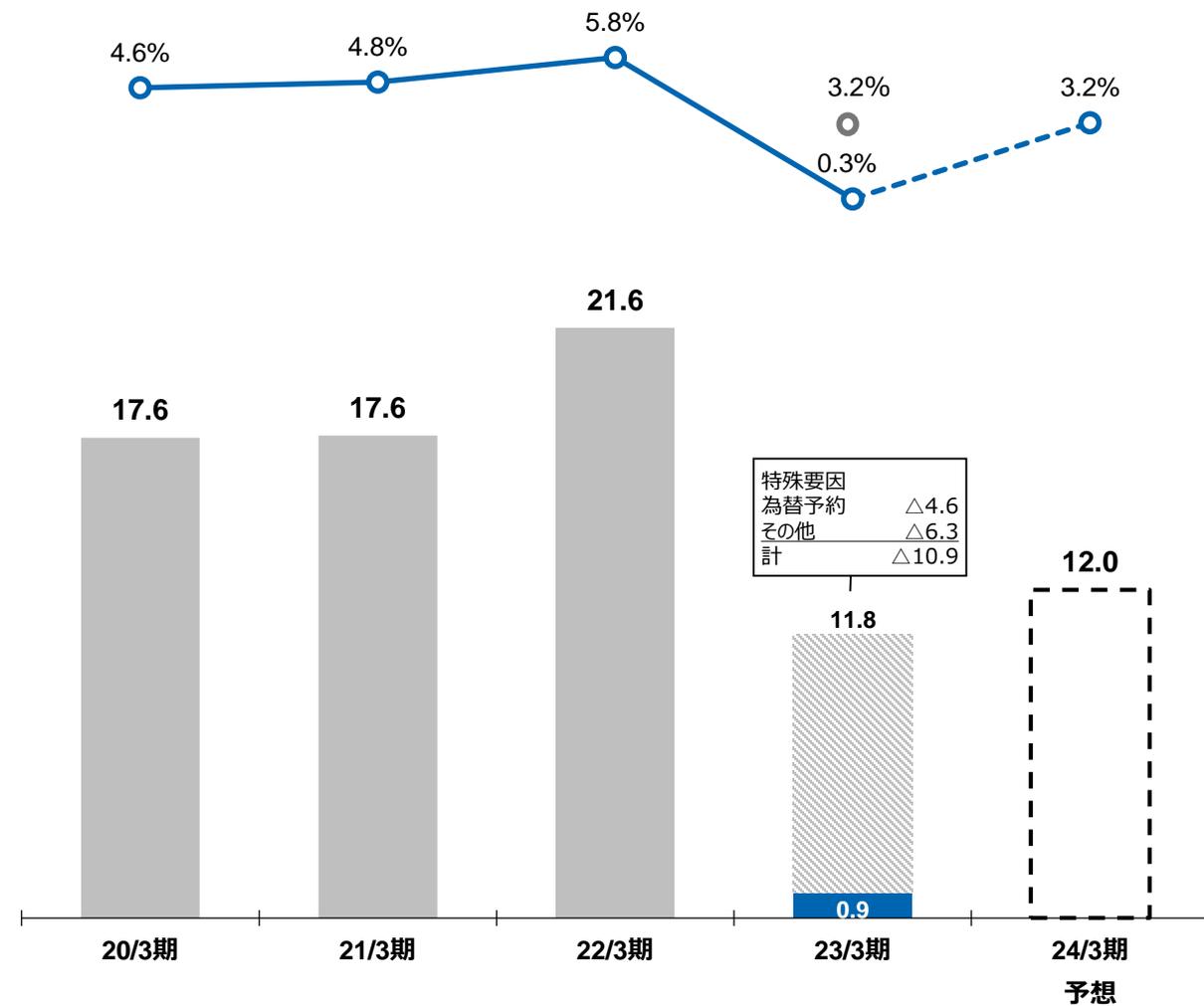
売上高 (10億円)

■ モーター ■ エレクトロデバイス ■ センシングデバイス ■ その他



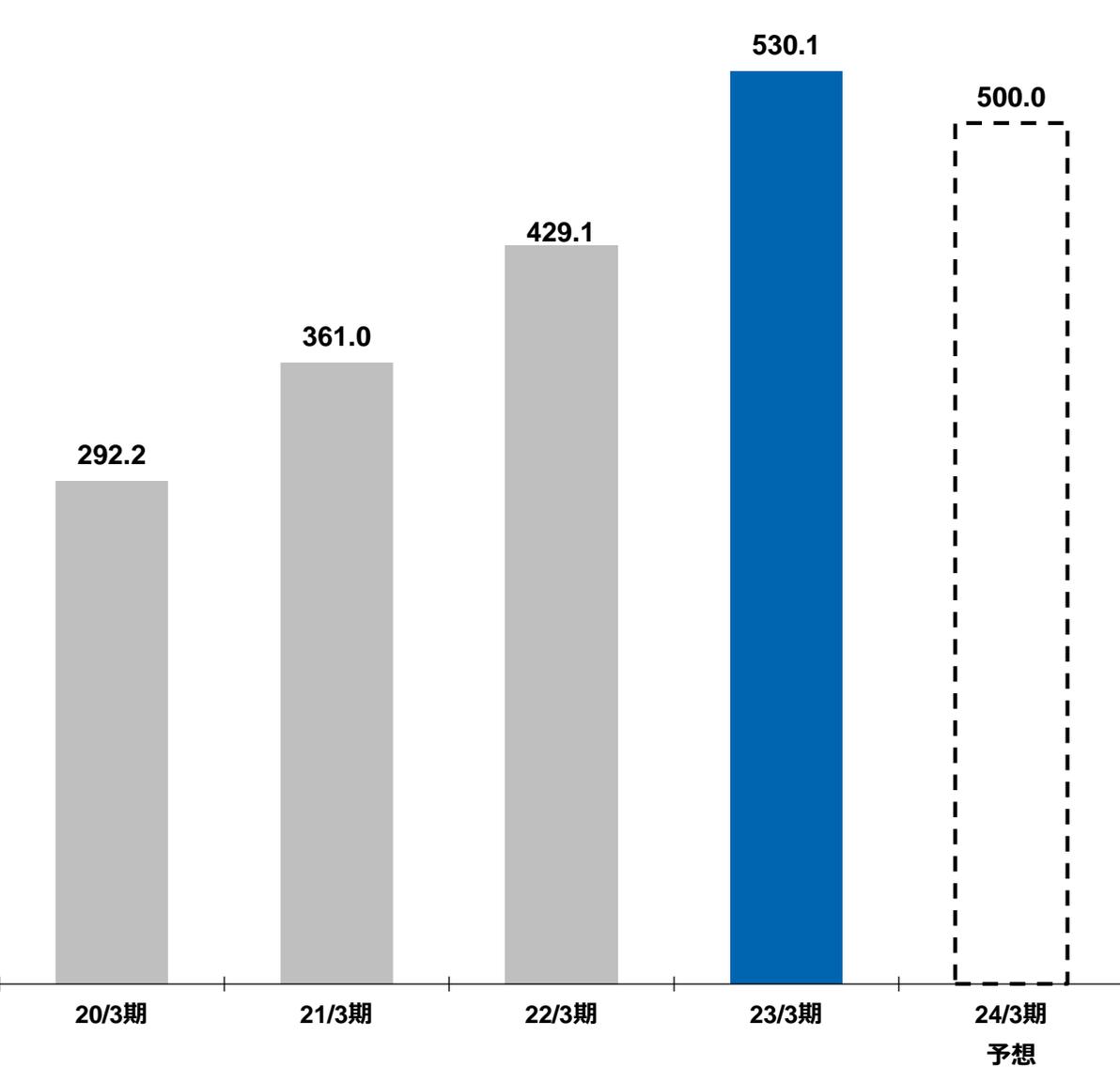
営業利益 (10億円)

■ 営業利益 ○ 営業利益率

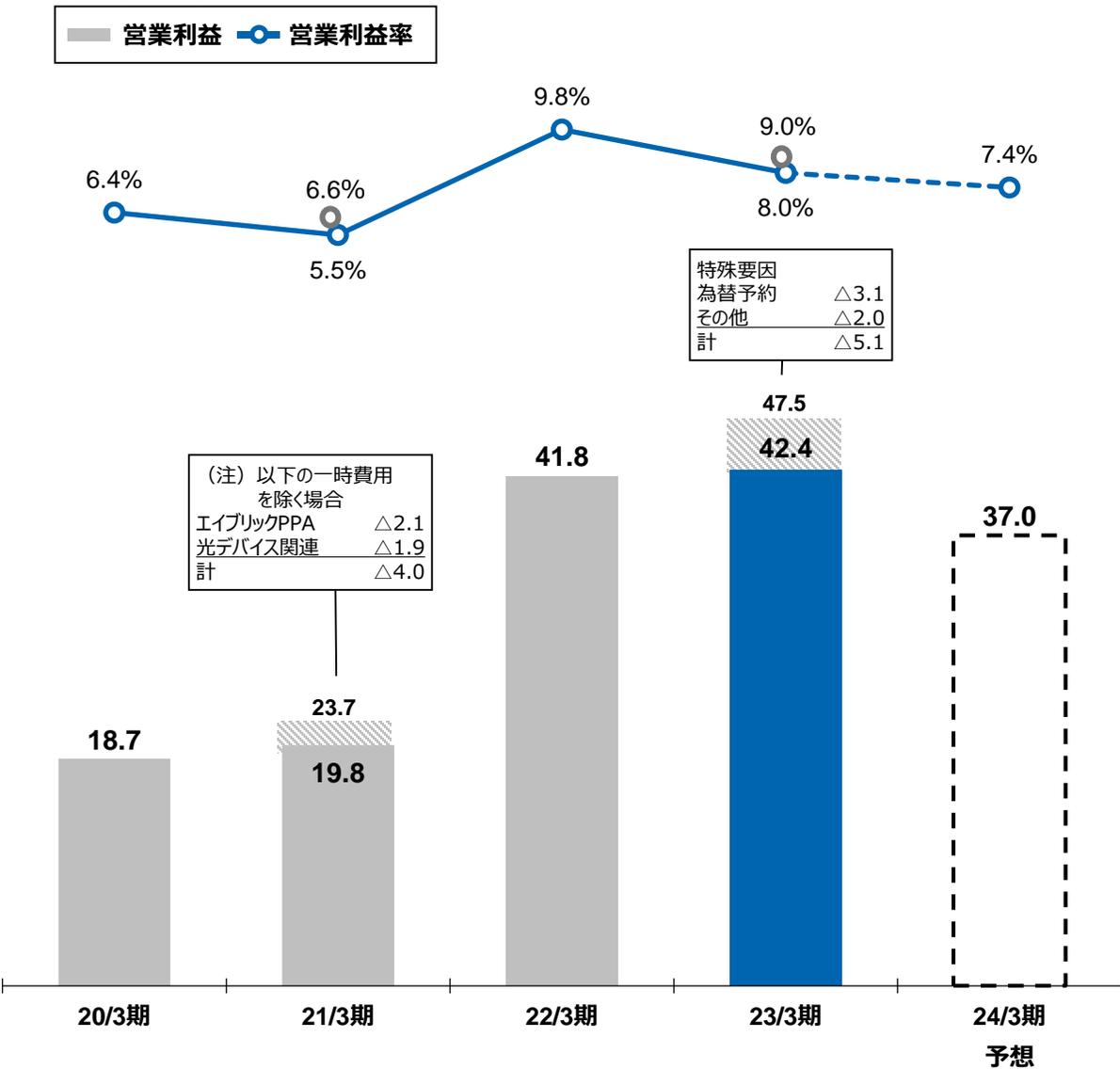


セミコンダクタ&エレクトロニクス セグメント (SE)

売上高 (10億円)



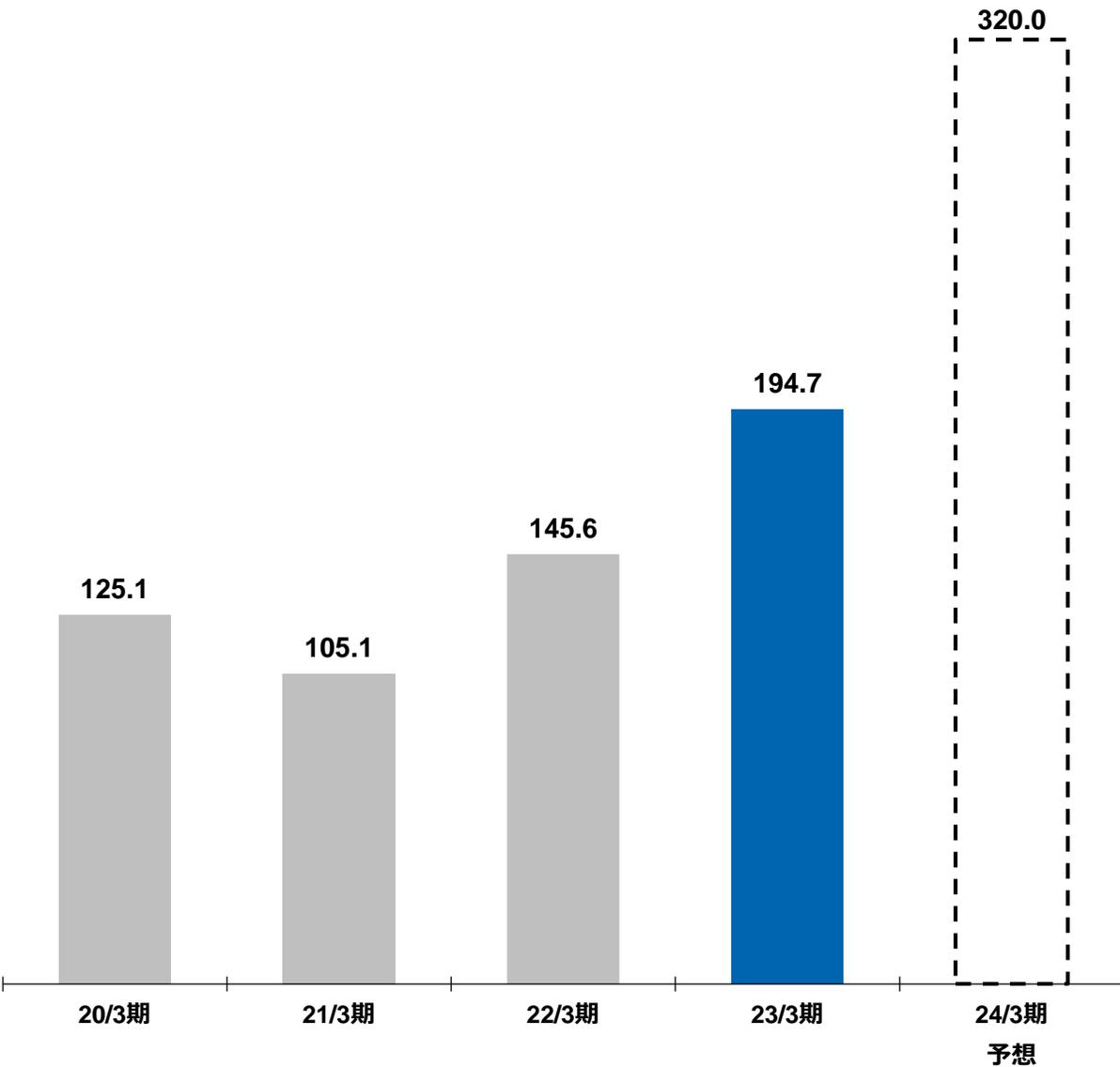
営業利益 (10億円)



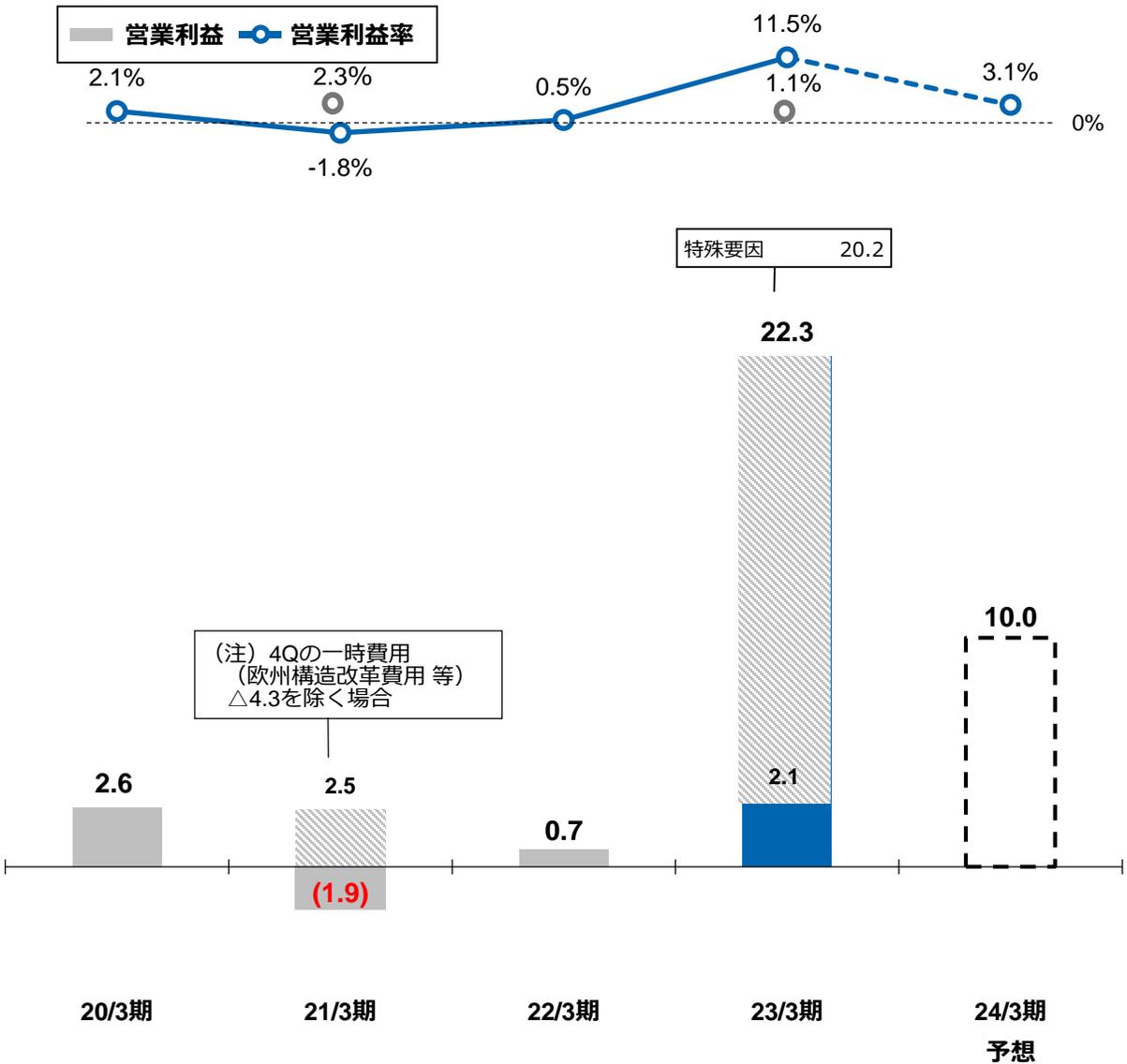
アクセスソリューションズ セグメント (AS)

決算期変更に伴い
20/3期は2019年1-3月
の数値を含まず

売上高 (10億円)



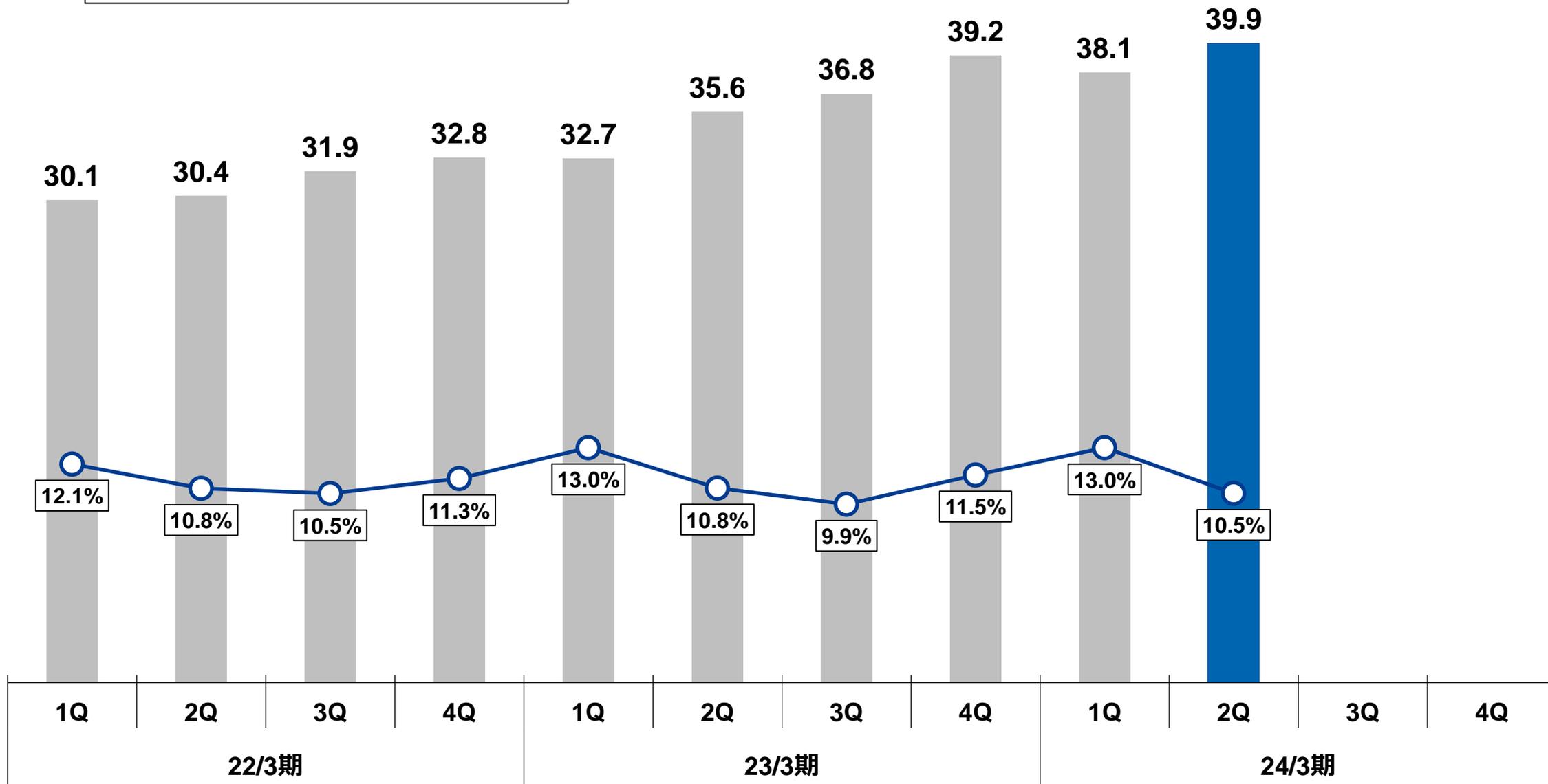
営業利益 (10億円)



販管費

(10億円)

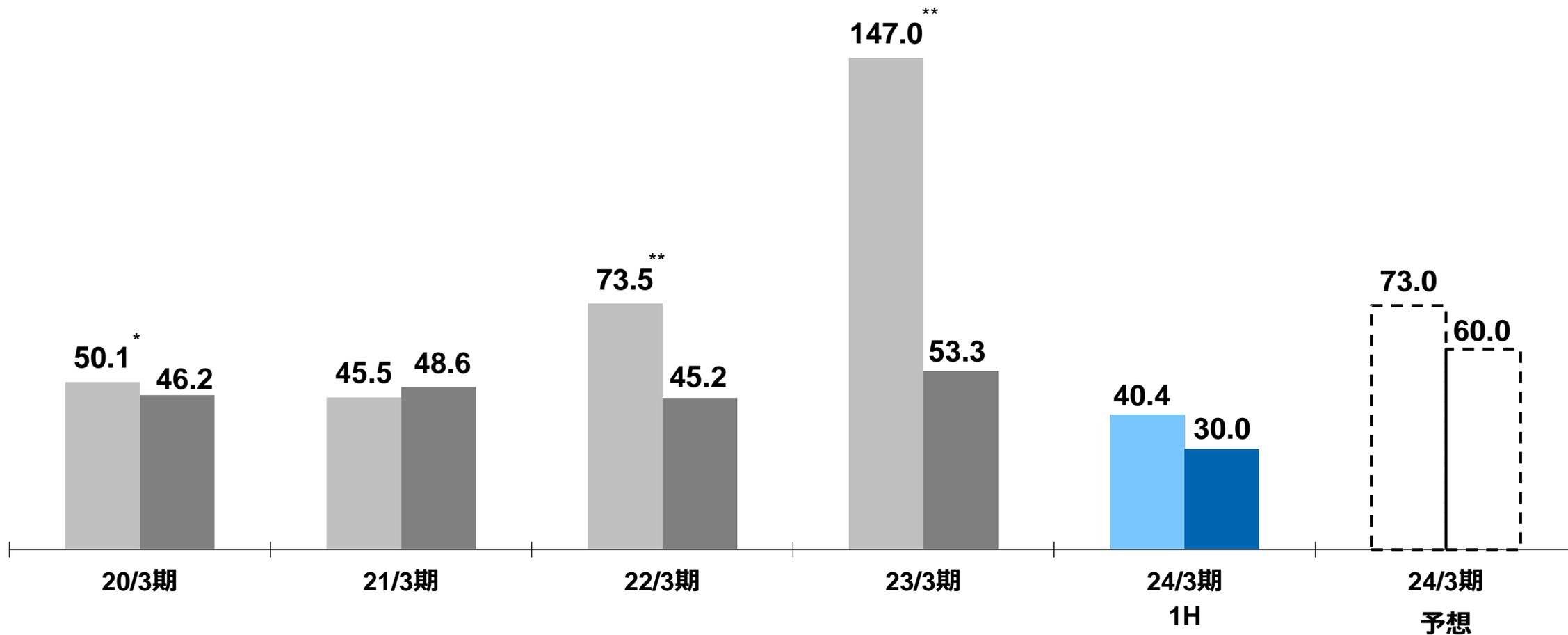
■ 販管費 ○ 売上高販管費比率



設備投資額・減価償却費

(10億円)

■ 設備投資額 ■ 減価償却費



*20/3期 設備投資額には、IFRS16号適用開始日に増加したリース資産は含まれていません。

**22/3期、23/3期の設備投資額には、新本部ビル取得費用が含まれています。

ROIC (投下資本利益率)

アクセスソリューションズ (AS) は19/3は経営統合前の参考値でJGAAP、全社には含めない。

$$\text{ミネベアミツミ版 ROIC} = \frac{\text{NOPAT (営業利益+特別損益)} \times (1 - \text{税率})}{\text{投下資本 (受取手形+売掛金+棚卸資産+固定資産-支払手形-買掛金)}}$$

セグメント別で管理できる事業資産（売上債権・債務、棚卸資産、固定資産）で算出

